

TPS35 Nano IQ 高精度電圧監視回路、高精度タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマ付き

1 特長

- 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なウォッチドッグ・タイムアウト
 - ±10% 精度のタイマ (最大値)
 - 工場出荷時にプログラム済み: 1msec ~ 100sec
- 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なリセット遅延
 - ±10% 精度のタイマ (最大値)
 - 工場出荷時にプログラム済みのオプション: 2msec ~ 10sec
- 入力電圧範囲: $V_{DD} = 1.04V \sim 6.0V$
- 固定スレッシュヨルド電圧 (V_{IT}): 1.05V ~ 5.4V
 - スレッシュヨルド電圧は 50mV 刻みで利用可能
 - 1.2% の電圧スレッシュヨルド精度 (最大値)
 - ヒステリシス内蔵 (V_{HYS}): 5% (標準値)
- 超低電源電流: $I_{DD} = 250nA$ (標準値)
- オープン・ドレイン、プッシュプル、アクティブ Low 出力
- 各種のプログラマビリティ・オプション:
 - ウォッチドッグ・イネーブル/ディセーブル
 - ウォッチドッグ・スタートアップ遅延: 遅延なし ~ 10 秒
 - オンザフライ (動作中) のタイマ拡張: 1 倍 ~ 256 倍
 - ラッチ付き出力オプション
- MR 機能のサポート

2 アプリケーション

- ロボット向けサーボ・ドライブ
- 混合モジュール (AI、AO、DI、DO)
- HVAC コントローラ
- 電気メーター
- 点滴用ポンプ
- 外科用機器

3 概要

TPS35 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、高精度電圧監視回路を備え、プログラム可能なタイムアウト ウォッチドッグ タイマを搭載しています。TPS35 は、低電圧監視のための広いスレッシュヨルド レベルをサポートしており、規定された温度範囲全体にわたって 1.2% の精度を達成しています。

TPS35 は、さまざまなアプリケーションに対応する多くの機能を備えた高精度のタイムアウト ウォッチドッグ タイマを提供します。このタイムアウト ウォッチドッグ タイマは工場出荷時にプログラムするか、または、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムするか、いずれかが可能です。このタイマ値は、ロジック ピンの組み合わせを使用して、動作中に変更することもできます。また、このウォッチドッグは、イネーブル/ディセーブル、スタートアップ遅延、独立 WDO ピン オプションなどの独自の機能も備えています。

RESET または WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、監視回路またはウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。

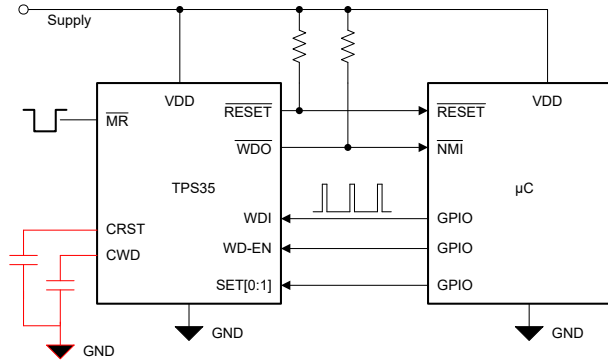
TPS35 は、TPS3851 デバイス ファミリに代わる性能アップグレード製品です。TPS35 は、小型の 6 ピン WSON および 8 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

製品情報

部品番号	パッケージ (1)	本体サイズ (公称)
TPS35	DDF (8)	2.90mm × 1.60mm
TPS35	DSE (6)	1.50mm × 1.50mm

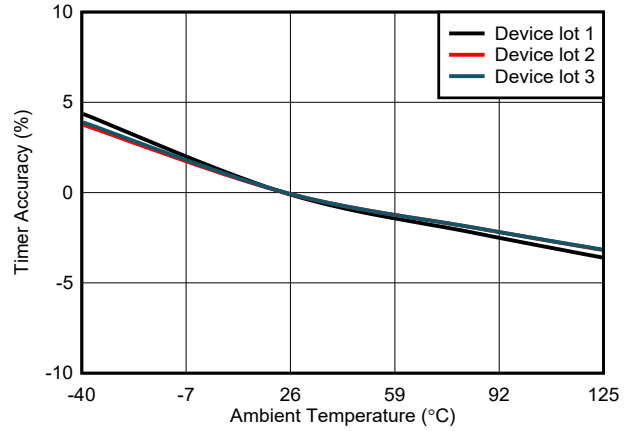
- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。





TPS35 offers various pinout options to support different features.
Choose suitable pinout based on application needs

代表的なアプリケーション回路

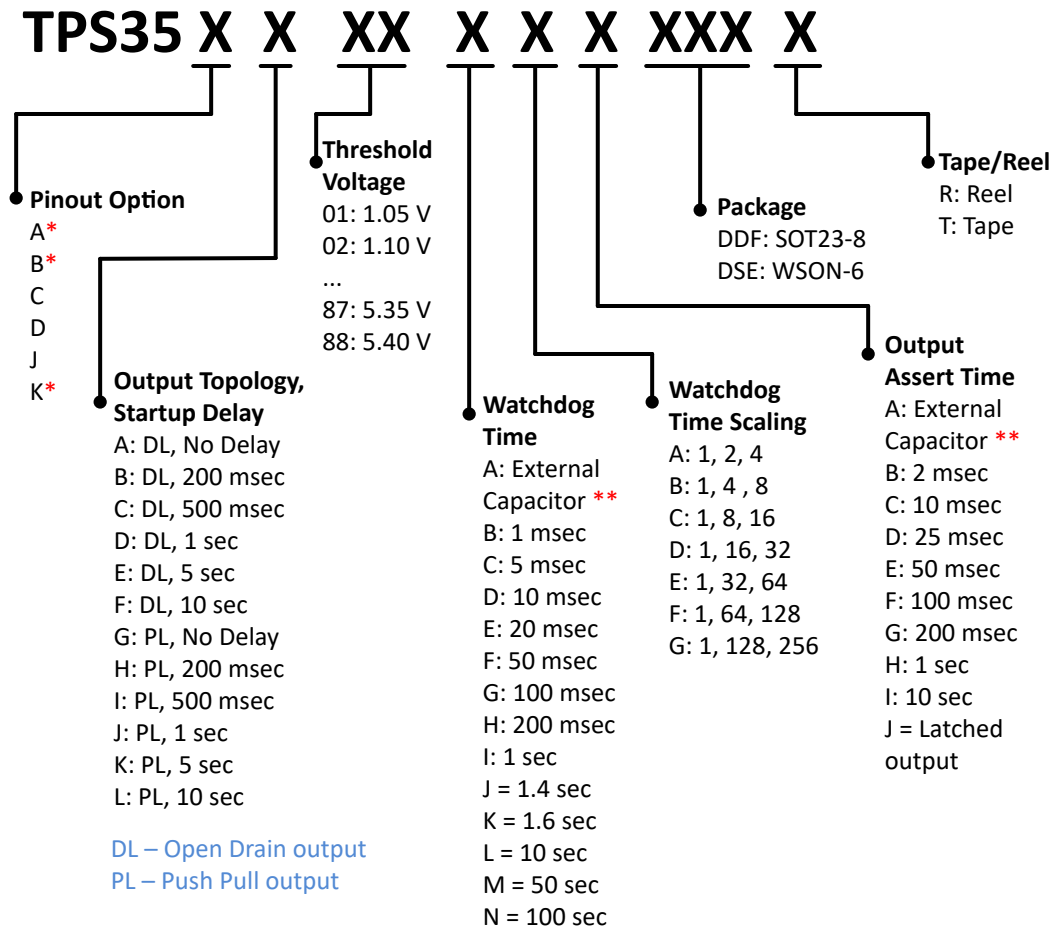


目次

1 特長	1	7.1 概要.....	16
2 アプリケーション	1	7.2 機能ブロック図	16
3 概要	1	7.3 機能説明	18
4 デバイスの比較	4	7.4 デバイスの機能モード	27
5 ピン構成および機能	5	8 アプリケーションと実装	28
6 仕様	7	8.1 アプリケーション情報	28
6.1 絶対最大定格	7	8.2 代表的なアプリケーション	29
6.2 ESD 定格	7	8.3 電源に関する推奨事項	30
6.3 推奨動作条件	7	8.4 レイアウト	31
6.4 熱に関する情報	8	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	32
6.5 熱に関する情報	8	9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法	32
6.6 電気的特性	9	9.2 サポート・リソース	32
6.7 タイミング要件	10	9.3 商標	33
6.8 スイッチング特性	11	9.4 静電気放電に関する注意事項	33
6.9 タイミング図	12	9.5 用語集	33
6.10 代表的特性	13	10 改訂履歴	33
7 詳細説明	16	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	33

4 デバイスの比較

図 4-1 に、TPS35 のデバイス命名規則を示します。可能なすべての出力タイプ、スレッシュホールド電圧オプション、ウォッチドッグ時間オプション、および出力アサート遅延オプションの詳細については、[セクション 7](#) を参照してください。他のオプションの詳細と提供状況については、テキサス・インスツルメンツの販売代理店またはテキサス・インスツルメンツの [E2E フォーラム](#) にお問い合わせください。



* Pinout option supports Start up Delay settings of “No Delay” and “10 sec” only.
 ** Capacitor programmable time feature available with pinout options A, B & K. For fixed time and latched output features use pinout options C, D & J.
 Refer ‘Mechanical, Packaging and Orderable Information’ section for list of released orderable.
 For any other orderable, contact local TI support.

図 4-1. デバイスの命名規則

TPS35 [表 4-1](#) に示すように、さまざまな機能セットを提供するピン互換デバイス・ファミリに属します。

表 4-1. ピン互換デバイス・ファミリ

デバイス	電圧監視	ウォッチドッグのタイプ
TPS35	あり	タイムアウト
TPS36	あり	ウィンドウ
TPS3435	なし	タイムアウト
TPS3436	なし	ウィンドウ

5 ピン構成および機能

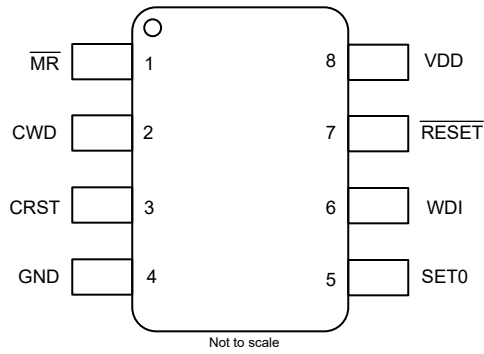


図 5-1. ピン構成オプション A
 DDF パッケージ、8 ピン SOT-23、
 TPS35 上面図

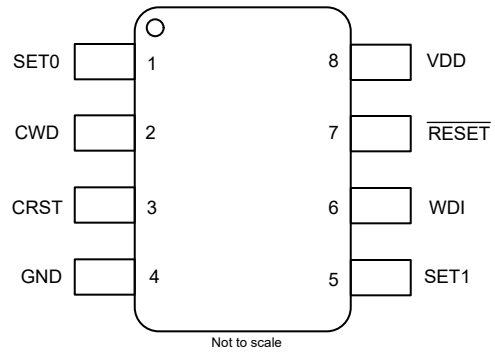


図 5-2. ピン構成オプション B
 DDF パッケージ、8 ピン SOT-23、
 TPS35 上面図

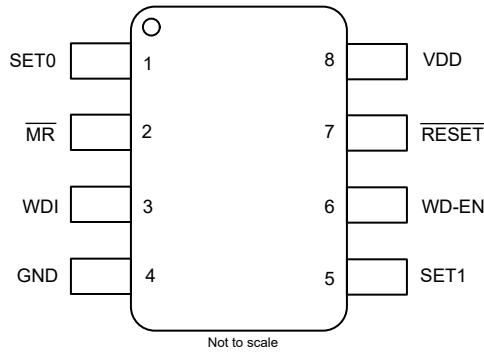


図 5-3. ピン構成オプション C
 DDF パッケージ、8 ピン SOT-23、
 TPS35 上面図

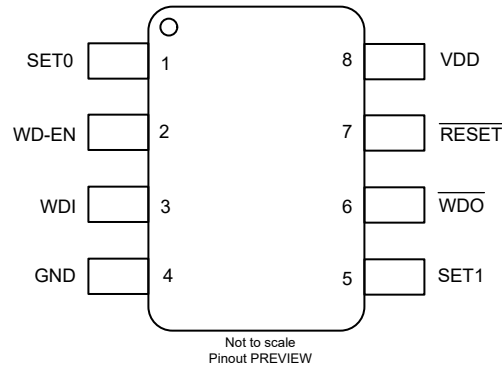


図 5-4. ピン構成オプション D
 DDF パッケージ、8 ピン SOT-23、
 TPS35 上面図

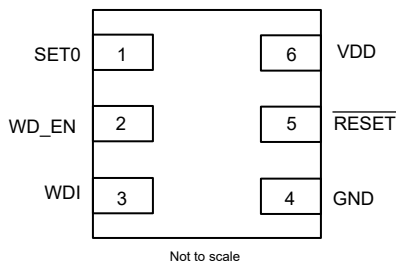


図 5-5. ピン構成オプション J
 DSE パッケージ、6 ピン WSON、
 TPS35 上面図

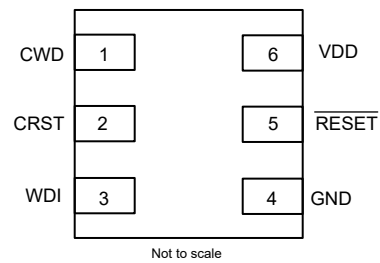


図 5-6. ピン構成オプション K
 DSE パッケージ、6 ピン WSON
 TPS35 上面図

表 5-1. ピン機能

ピン名	ピン番号						I/O	説明
	ピン配置 A	ピン配置 B	ピン配置 C	ピン配置 D	ピン配置 J	ピン配置 K		
CRST	3	3	—	—	—	2	I	プログラム可能なリセット タイムアウト ピン。このピンと GND の間にコンデンサを接続して、リセット タイムアウト期間を設定します。詳細については、 セクション 7.3.4 を参照してください。
CWD	2	2	—	—	—	1	I	プログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト入力。ウォッチドッグ タイムアウトは、このピンとグラウンドの間にコンデンサを接続することで設定します。詳細については、 セクション 7.3.2.1 を参照してください。
GND	4	4	4	4	4	4	—	グラウンドピン
MR	1	—	2	—	—	—	I	手動のリセットピン。このピンがロジック Low になると、RESET がアサートされます。詳細については、 セクション 7.3.3 を参照してください。
RESET	7	7	7	7	5	5	O	リセット出力。オープン ドレイン出力を使用する場合は、プルアップ抵抗を使用して RESET を VDD に接続します。VDD ピンの電圧が低電圧スレッショルド (V_{IT}) を下回るか、MR ピンが Low に駆動されると、RESET がアサートされます。独立した WDO ピンをサポートしないピン配置オプションでは、ウォッチドッグ エラーが発生したときにも RESET がアサートされます。詳細については、 セクション 7.3.4 を参照してください。
SET0	5	1	1	1	1	—	I	ロジック入力。SET0、SET1、WD-EN ピンは、ウォッチドッグを選択し、ウォッチドッグをイネーブル/ディセーブルします。詳細については、 セクション 7.3.2.4 を参照してください。
SET1	—	5	5	5	—	—	I	ロジック入力。SET0、SET1、WD-EN ピンは、ウォッチドッグを選択し、ウォッチドッグをイネーブル/ディセーブルします。詳細については、 セクション 7.3.2.4 を参照してください。
VDD	8	8	8	8	6	6	I	電源電圧ピン。ノイズの多いシステムでは、0.1 μ F のバイパス コンデンサを接続することを推奨します。
WD-EN	—	—	6	2	2	—	I	ロジック入力。ロジック High になると、ウォッチドッグ監視機能がイネーブルになります。詳細については、 セクション 7.3.2.2 を参照してください。
WDI	6	6	3	3	3	3	I	ウォッチドッグ入力。RESET/WDO がアサートされないようにするには、タイムアウトが終了する前にこのピンで立ち下がり遷移 (エッジ) が発生する必要があります。詳細については、 セクション 7.3.2 を参照してください。
\overline{WDO}	—	—	—	6	—	—	O	ウォッチドッグ出力。オープン ドレイン出力を使用する場合は、プルアップ抵抗を使用して WDO を VDD に接続します。ウォッチドッグ エラーが発生すると、WDO がアサートされます。WDO は、RESET が High の場合にのみアサートされます。ウォッチドッグ エラーが発生すると、設定された RESET タイムアウト遅延 (t_D) の間 WDO がアサートされます。RESET がアサートされると、WDO はデアサートされ、ウォッチドッグ機能はディセーブルされます。詳細については、 セクション 7.3.4 を参照してください。

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
電圧	VDD	-0.3	6.5	V
電圧	C _{WD} 、C _{RST} 、WD-EN、SETx、WDI、MR ⁽²⁾ 、WDO (プッシュアップル)	-0.3	V _{DD} +0.3 ⁽³⁾	V
	RESET (オープン ドレイン)、WDO (オープン ドレイン)	-0.3	6.5	
電流	WDO ピン	-20	20	mA
温度 ⁽⁴⁾	動作時の周囲温度、T _A	-40	125	°C
温度	保存、T _{stg}	-65	150	

- (1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての話で、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
- (2) MR を駆動するロジック信号が V_{DD} を下回ると、追加の電流が V_{DD} から MR に流れます。
- (3) 絶対最大定格は、(V_{DD} + 0.3)V または 6.5V のどちらか小さい方です。
- (4) このデバイスの消費電力は低いため、T_J = T_A と想定されます。

6.2 ESD 定格

		値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	±2000
		荷電デバイス モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 準拠 ⁽²⁾	±750

- (1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
電圧	VDD (アクティブ Low 出力)	0.9		6	V
	C _{WD} 、C _{RST} 、WD-EN、SETx、WDI、MR ⁽¹⁾	0		V _{DD}	
	RESET (オープン ドレイン)、WDO (オープン ドレイン)	0		6	
	RESET (オープン ドレイン)、WDO (プッシュアップル)	0		V _{DD}	
電流	RESET、WDO ピン電流	-5		5	mA
C _{RST}	C _{RST} ピンのコンデンサ範囲	1.5		1800	nF
C _{WD}	C _{WD} ピンのコンデンサ範囲	1.5		1000	nF
T _A	動作時周囲温度	-40		125	°C

- (1) MR を駆動するロジック信号が V_{DD} を下回ると、追加の電流が V_{DD} から MR に流れます。V_{MR} は V_{DD} 以下にする必要があります。

6.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		TPS35	単位
		DDF (SOT23-8)	
		8 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	175.3	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	94.7	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	92.4	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	8.4	°C/W
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	91.9	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション レポートを参照してください。

6.5 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		TPS35	単位
		DSE (WSON-6)	
		6 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	199.0	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	121.4	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	104.3	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	11.3	°C/W
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	103.8	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション レポートを参照してください。

6.6 電気的特性

1.04V ≤ V_{DD} ≤ 6V、MR = オープン、RESE_T の V_{DD} へのプルアップ抵抗 (R_{pull-up}) = 100kΩ、WDO の V_{DD} へのプルアップ抵抗 (R_{pull-up}) = 100kΩ、出力負荷 (C_{LOAD}) = 10pF、自由気流での動作温度範囲内 -40°C ~ 125°C (特に記述のない限り) V_{DD} ランプレート ≤ 1V/μs。代表値は T_A = 25°C 時に測定

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位	
共通パラメータ							
V _{DD}	入力電源電圧	アクティブ Low 出力	1.04		6	V	
V _{IT-}	負方向の入カスレッシュヨルド精度 ⁽¹⁾	V _{IT-} = 1.05V ~ 1.95V	-1.4	±0.5	1.4	%	
		V _{IT-} = 2.0V ~ 5.4V	-1.2	±0.5	1.2		
V _{HYS}	ヒステリシス V _{IT-} ピン	V _{IT-} = 1.05V ~ 5.4V	3	5	7	%	
I _{DD}	V _{DD} ピンへの電源電流 ⁽²⁾	V _{DD} = 2V V _{IT-} = 1.05V ~ 1.95V	T _A = -40°C ~ 85°C		0.25	0.8	μA
					0.25	3	
		V _{DD} = 6V V _{IT-} = 1.05V ~ 5.4V	T _A = -40°C ~ 85°C		0.25	0.8	
					0.25	3	
V _{IL}	Low レベル入力電圧 WD-EN、WDI、SETx、MR ⁽²⁾				0.3V _{DD}	V	
V _{IH}	High レベル入力電圧 WD-EN、WDI、SETx、MR ⁽²⁾		0.7V _{DD}			V	
R _{MR}	手動リセットの内部プルアップ抵抗			100		kΩ	
RESE_T / WDO (オープン ドレイン アクティブ Low)							
V _{OL}	Low レベル出力電圧	V _{DD} = 1.5V、1.55V ≤ V _{IT-} ≤ 3.35V I _{OUT(Sink)} = 500μA			300	mV	
		V _{DD} = 3.3V、3.4V ≤ V _{IT-} ≤ 5.4V I _{OUT(Sink)} = 2mA			300	mV	
I _{kg(OD)}	オープン ドレイン出力リーク電流	V _{DD} = V _{PULLUP} = 6V T _A = -40°C ~ 85°C		10	30	nA	
		V _{DD} = V _{PULLUP} = 6V		10	120	nA	
RESE_T / WDO (プッシュプル アクティブ Low)							
V _{POR}	パワーオン RESE _T 電圧 ⁽³⁾	V _{OL(max)} = 300mV I _{OUT(Sink)} = 15μA			900	mV	
V _{OL}	Low レベル出力電圧	V _{DD} = 0.9V、1.05V ≤ V _{IT-} ≤ 1.5V I _{OUT(Sink)} = 15μA			300	mV	
		V _{DD} = 1.5V、1.55V ≤ V _{IT-} ≤ 3.35V I _{OUT(Sink)} = 500μA			300		
		V _{DD} = 3.3V、3.4V ≤ V _{IT-} ≤ 5.4V I _{OUT(Sink)} = 2mA			300		
V _{OH}	High レベル出力電圧	V _{DD} = 1.8V、1.05V ≤ V _{IT-} ≤ 1.4V I _{OUT(Source)} = 500μA	0.8V _{DD}			V	
		V _{DD} = 3.3V、1.45V ≤ V _{IT-} ≤ 3.0V I _{OUT(Source)} = 500μA	0.8V _{DD}				
		V _{DD} = 6V、3.05V ≤ V _{IT-} ≤ 5.4V I _{OUT(Source)} = 2mA	0.8V _{DD}				

- (1) V_{IT-} スレッシュヨルド電圧範囲は 1.05V ~ 5.4V で、50mV 刻みです。
(2) MR を駆動するロジック信号が V_{DD} を下回ると、追加の電流が V_{DD} から MR に流れます。
(3) V_{POR} は、制御された出力状態の最小 V_{DD} 電圧レベルです。

6.7 タイミング要件

1.04V ≤ V_{DD} ≤ 6V、MR = オープン、RESET の V_{DD} へのプルアップ抵抗 (R_{pull-up}) = 100kΩ、WDO の V_{DD} へのプルアップ抵抗 (R_{pull-up}) = 100kΩ、出力 RESET / WDO の負荷 (C_{LOAD}) = 10pF、自由気流での動作温度範囲内 -40°C ~ 125°C (特に記述のない限り)V_{DD} ランプレート ≤ 1V/μs。代表値は T_A = 25°C 時に測定

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
t _{GL_VIT-}	グリッチ耐性 V _{IT-}	5% V _{IT-} オーバードライブ ⁽¹⁾		15		μs
t _{MR_PW}	リセットをアサートするための MR ピンのパルス期間			100		ns
t _{P-WD}	次のフレームを開始するための WDI パルス期間 ⁽²⁾	V _{DD} > V _{IT-}	500			ns
t _{HD-WDEN}	WD 動作をイネーブルまたはディセーブルにするための WD-EN のホールド時間 ⁽²⁾	V _{DD} > V _{IT-}	200			μs
t _{HD-SETx}	WD タイマ設定を変更するための SETx のホールド時間 ⁽²⁾	V _{DD} > V _{IT-}	150			μs
t _{WD}	ウォッチドッグのタイムアウト期間	注文可能なオプション : TPS35xxxxB	0.8	1	1.2	ms
		注文可能なオプション : TPS35xxxxC	4	5	6	
		注文可能なオプション : TPS35xxxxD	9	10	11	
		注文可能なオプション : TPS35xxxxE	18	20	22	
		注文可能なオプション : TPS35xxxxF	45	50	55	
		注文可能なオプション : TPS35xxxxG	90	100	110	
		注文可能なオプション : TPS35xxxxH	180	200	220	s
		注文可能なオプション : TPS35xxxxI	0.9	1	1.1	
		注文可能なオプション : TPS35xxxxJ	1.26	1.4	1.54	
		注文可能なオプション : TPS35xxxxK	1.44	1.6	1.76	
		注文可能なオプション : TPS35xxxxL	9	10	11	
		注文可能なオプション : TPS35xxxxM	45	50	55	
		注文可能なオプション : TPS35xxxxN	90	100	110	

(1) オーバードライブ % = [(V_{DD}/ V_{IT-}) - 1] × 100%

(2) 量産では検査していません。

6.8 スイッチング特性

1.04V ≤ V_{DD} ≤ 6V、MR = オープン、RESET の V_{DD} へのプルアップ抵抗 (R_{pull-up}) = 100kΩ、WDO の V_{DD} へのプルアップ抵抗 (R_{pull-up}) = 100kΩ、出力 RESET / WDO の負荷 (C_{LOAD}) = 10pF、自由気流での動作温度範囲内 -40°C ~ 125°C (特に記述のない限り)V_{DD} ランプ レート ≤ 1V/μs。代表値は T_A = 25°C 時に測定

パラメータ	テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位	
t _{STRT}	スタートアップ遅延 ⁽²⁾			500	μs	
t _{P_HL}	V _{DD} が V _{IT-} を下回ったときの RESET 検出遅延	V _{DD} : (V _{IT+} + 10%) to (V _{IT-} - 10%) ⁽¹⁾		30	50	μs
t _{SD}	ウォッチドッグのスタートアップ遅延	注文可能な部品番号 : TPS35xA, TPS35xG		0		ms
		注文可能な部品番号 : TPS35xB, TPS35xH	180	200	220	
		注文可能な部品番号 : TPS35xC, TPS35xI	450	500	550	
		注文可能な部品番号 : TPS35xD, TPS35xJ	0.9	1	1.1	s
		注文可能な部品番号 : TPS35xE, TPS35xK	4.5	5	5.5	
		注文可能な部品番号 : TPS35xF, TPS35xL	9	10	11	
t _D	リセット時間遅延 ⁽³⁾	注文可能な部品番号 : TPS35xxxxxB	1.6	2	2.4	ms
		注文可能な部品番号 : TPS35xxxxxC	9	10	11	ms
		注文可能な部品番号 : TPS35xxxxxD	22.5	25	27.5	ms
		注文可能な部品番号 : TPS35xxxxxE	45	50	55	ms
		注文可能な部品番号 : TPS35xxxxxF	90	100	110	ms
		注文可能な部品番号 : TPS35xxxxxG	180	200	220	ms
		注文可能な部品番号 : TPS35xxxxxH	0.9	1	1.1	s
		注文可能な部品番号 : TPS35xxxxxI	9	10	11	s
t _{WDO}	ウォッチドッグのタイムアウト遅延		t _D		s	
t _{MR_RES}	MR が Low になってからリセットがアサートされるまでの伝搬遅延	V _{DD} ≥ V _{IT-} + 0.2V, MR = V _{MR_H} から V _{MR_L}		100	ns	
t _{MR_ID}	MR が解放されてからリセットがデアサートされるまでの遅延	V _{DD} = 3.3V, MR = V _{MR_L} から V _{MR_H}		t _D	s	

- (1) t_{P_HL} は、スレッシュホールドのトリップポイント (V_{IT-}) から RESET のアサートまでを測定したものです。V_{IT+} = V_{IT-} + V_{HYS}
(2) 設計パラメータにより規定されています。V_{DD} が指定された最小 V_{DD} よりも低い電圧から開始して V_{IT+} を超えると、スタートアップ遅延 (t_{STRT}) + t_D 遅延後にリセットがデアサートされます。
(3) V_{DD} 電圧が (V_{IT-} - 10%) から (V_{IT-} + 10%) に遷移

6.9 タイミング図

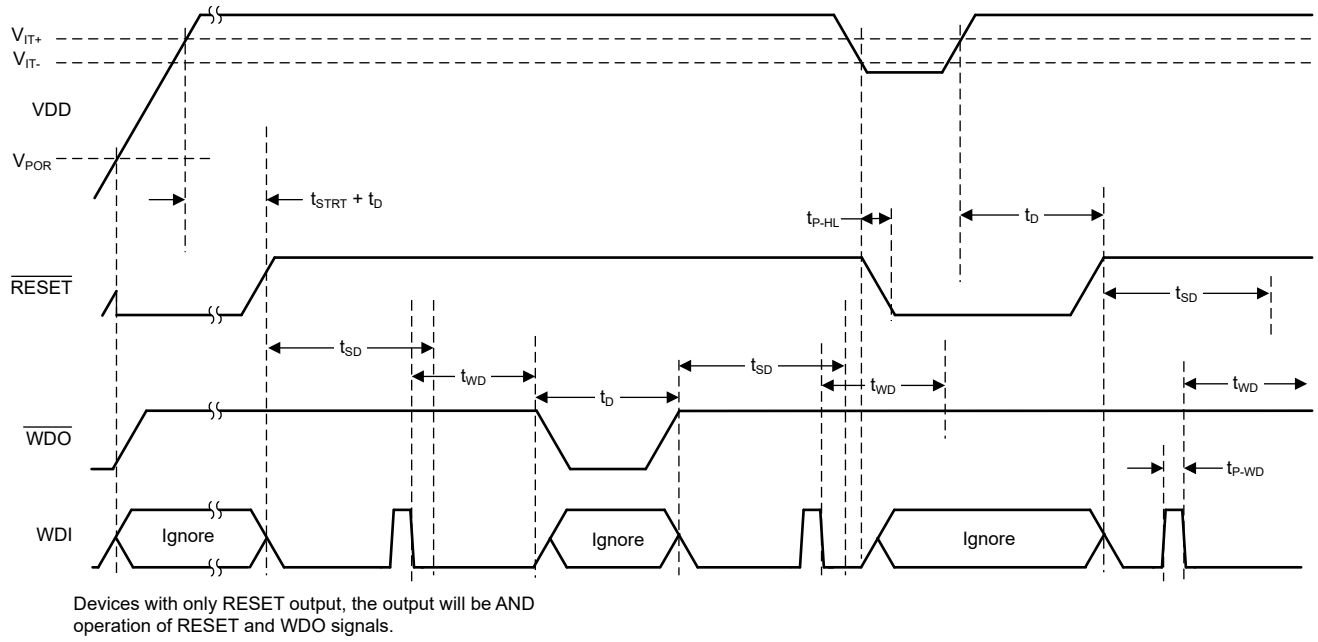


図 6-1. 動作時のタイミング図

6.10 代表的特性

すべての曲線は $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定 (特に記述のない限り)

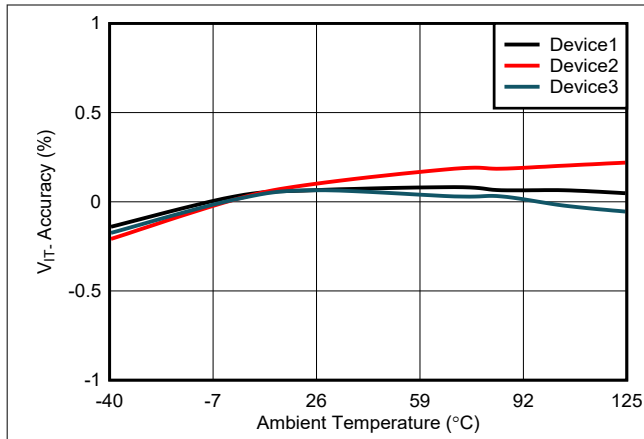


図 6-2. V_{IT} の精度と温度との関係

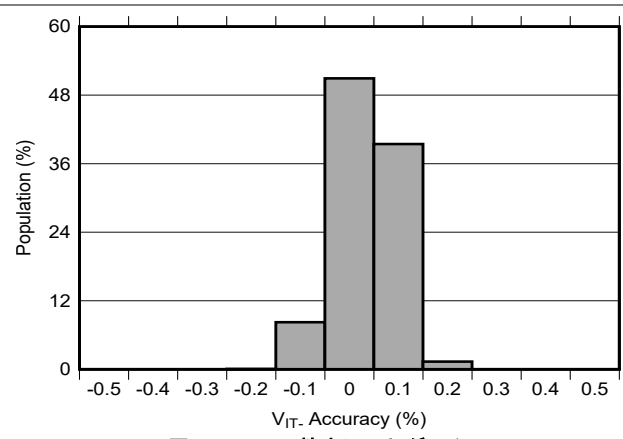


図 6-3. V_{IT} の精度ヒストグラム

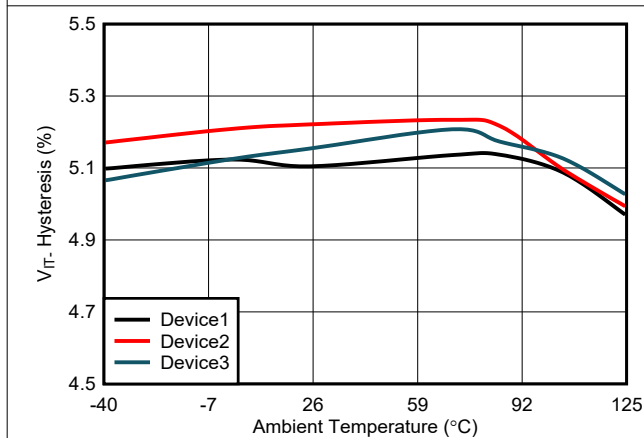


図 6-4. V_{IT} のヒステリシスと温度との関係

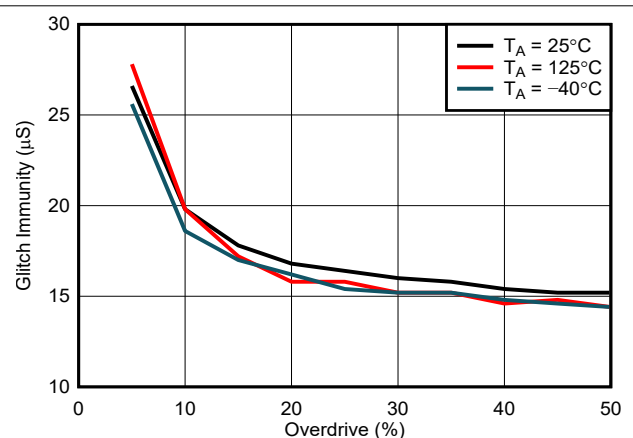


図 6-5. 電源グリッチ耐性とオーバードライブとの関係

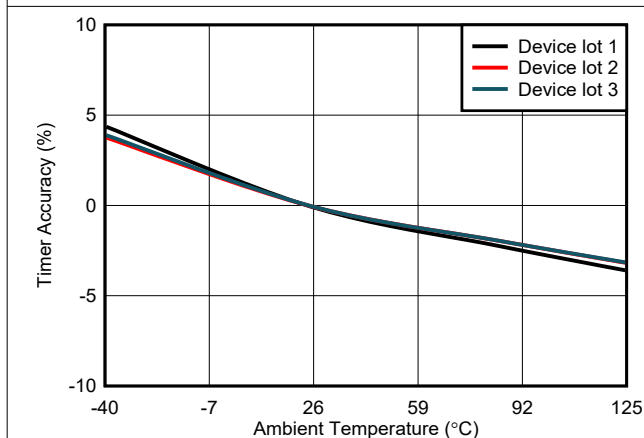


図 6-6. タイマの精度と温度との関係

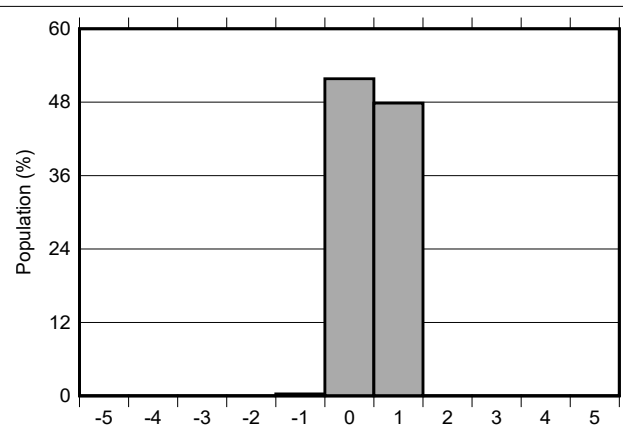
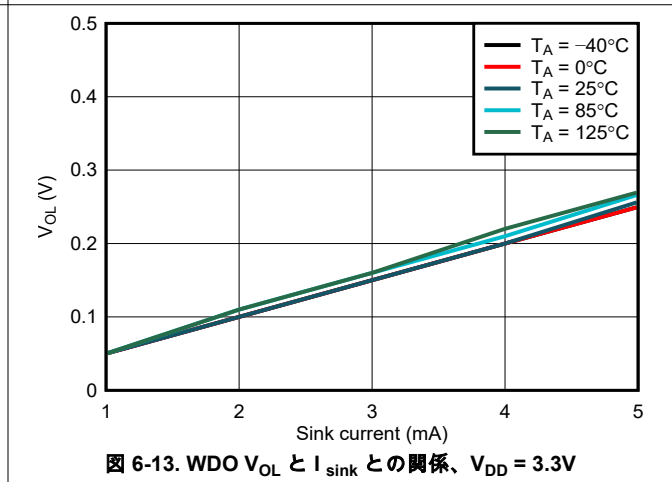
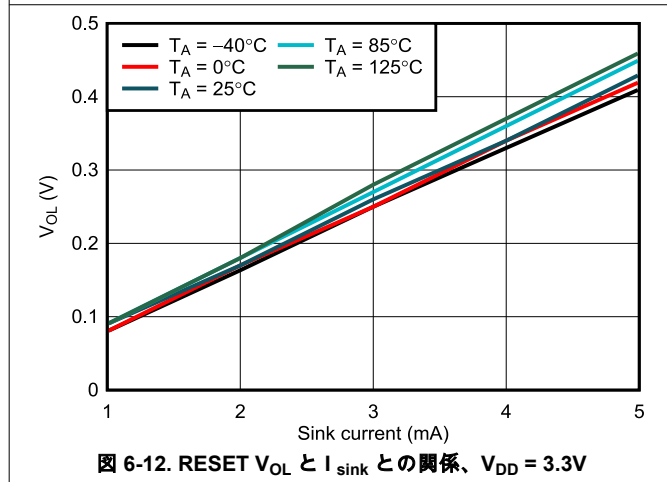
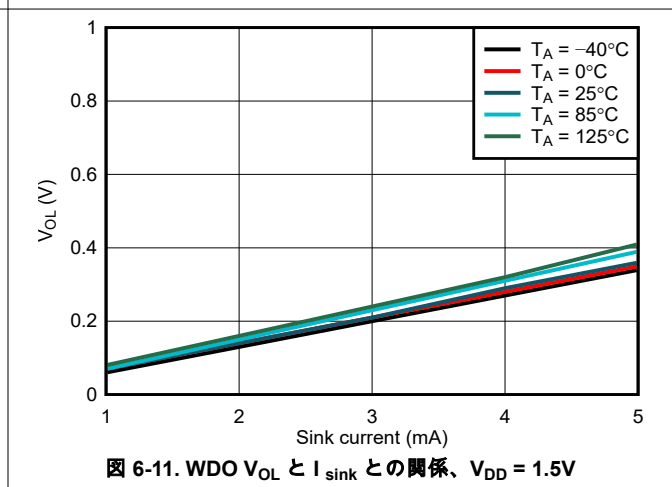
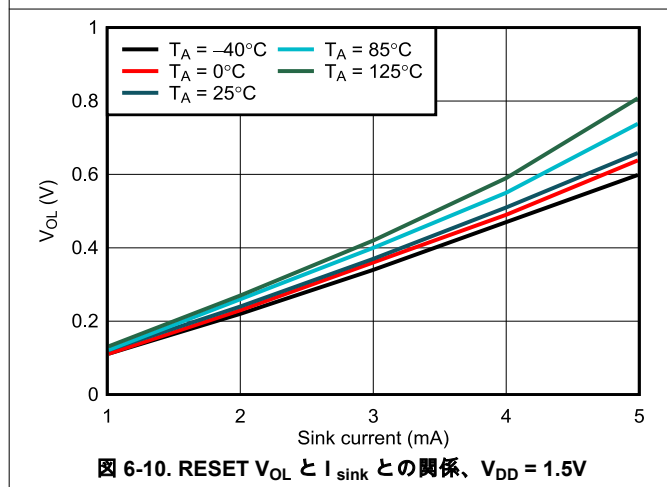
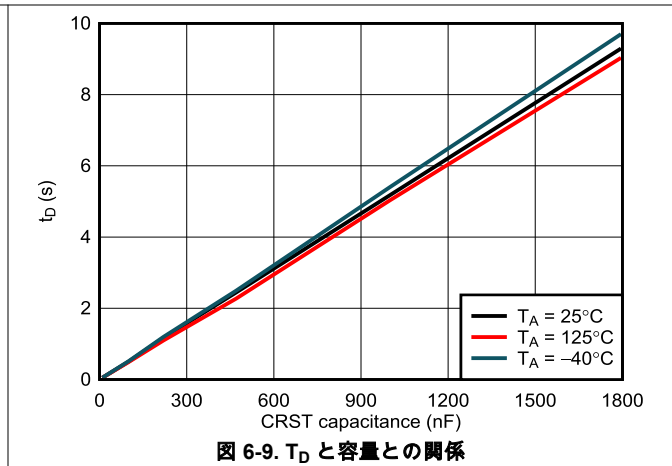
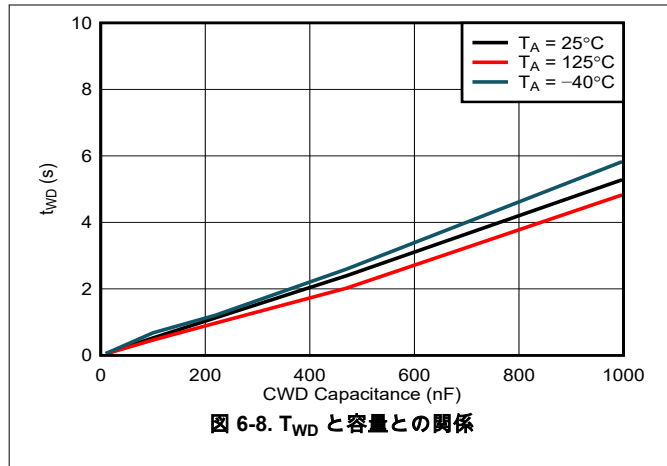


図 6-7. タイマの精度ヒストグラム

6.10 代表的特性 (続き)

すべての曲線は $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定 (特に記述のない限り)



6.10 代表的特性 (続き)

すべての曲線は $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定 (特に記述のない限り)

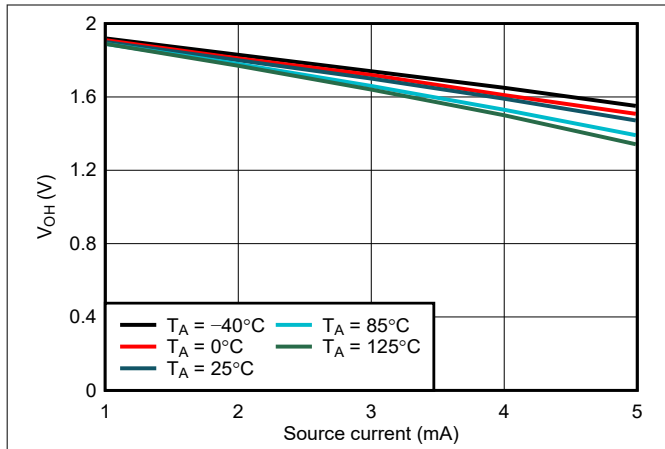


図 6-14. RESET V_{OH} と I_{source} との関係、 $V_{DD} = 2.0\text{V}$

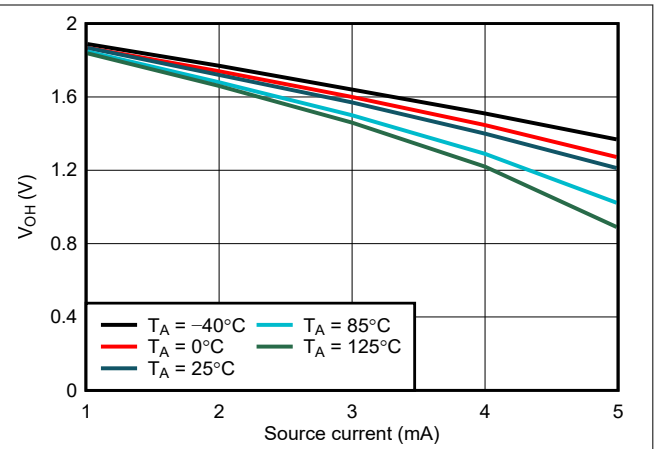


図 6-15. WDO V_{OH} と I_{source} との関係、 $V_{DD} = 2.0\text{V}$

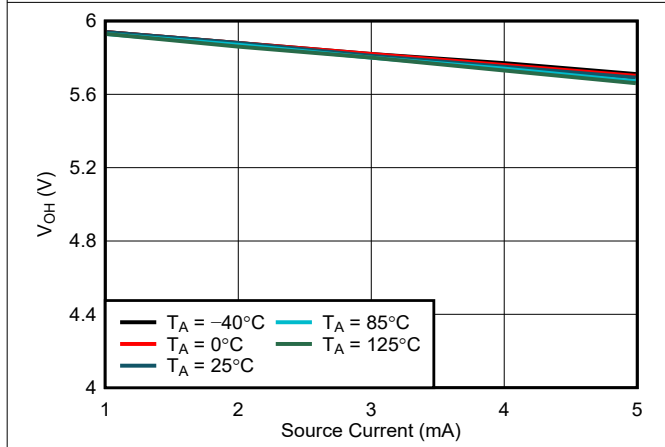


図 6-16. RESET V_{OH} と I_{source} との関係、 $V_{DD} = 6.0\text{V}$

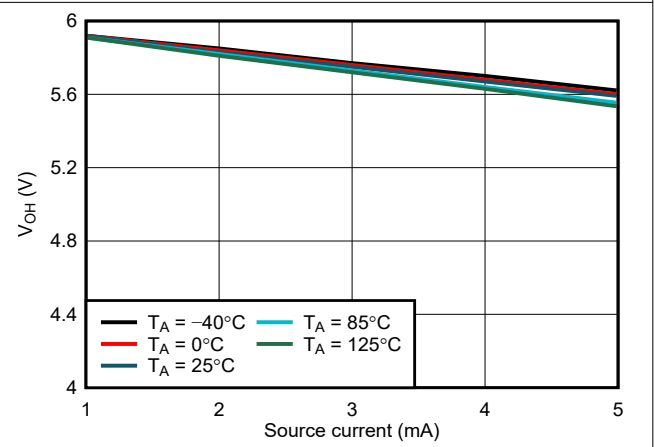


図 6-17. WDO V_{OH} と I_{source} との関係、 $V_{DD} = 6.0\text{V}$

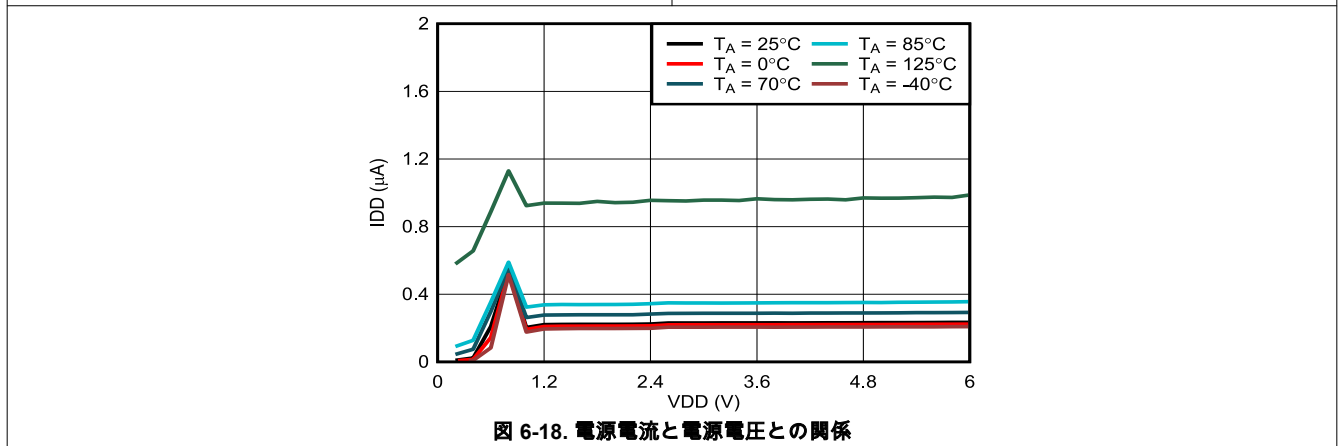


図 6-18. 電源電流と電源電圧との関係

7 詳細説明

7.1 概要

TPS35 は、タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマ・デバイスが内蔵された高精度の低電圧スーパーバイザです。このデバイス・ファミリは、ウォッチドッグ動作に関連する複数の機能をサポートしており、小型の 6 ピン WSON および 8 ピン SOT23 パッケージで提供されています。このデバイスには、6 個の異なるピン配置構成があります。ピン配置によって、さまざまなアプリケーション要件を満たす異なる機能を使用できます。

7.2 機能ブロック図

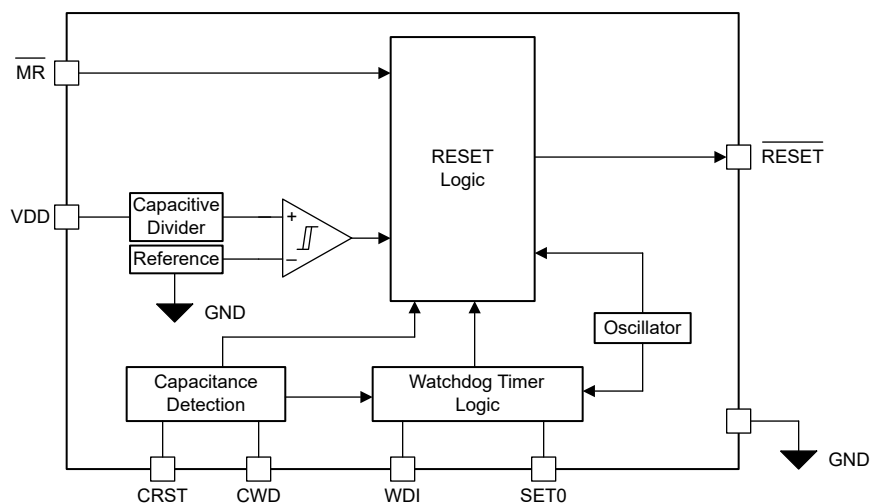


図 7-1. ピン配置オプション A

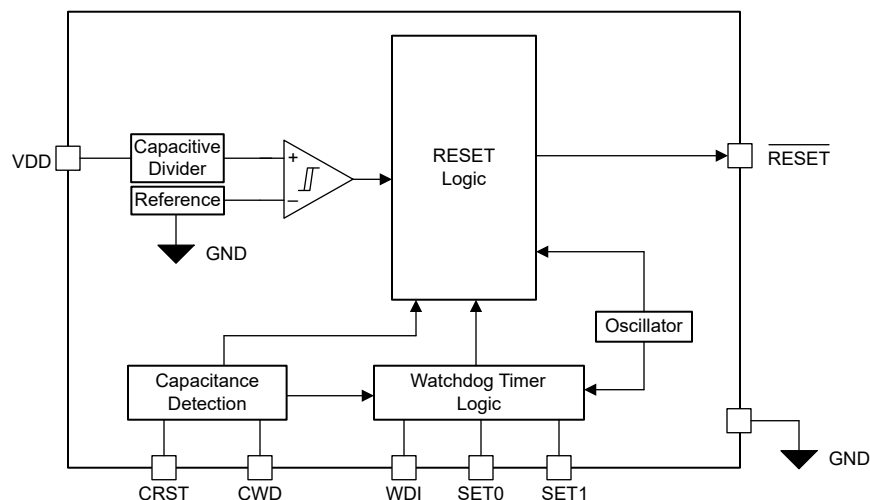


図 7-2. ピン配置オプション B

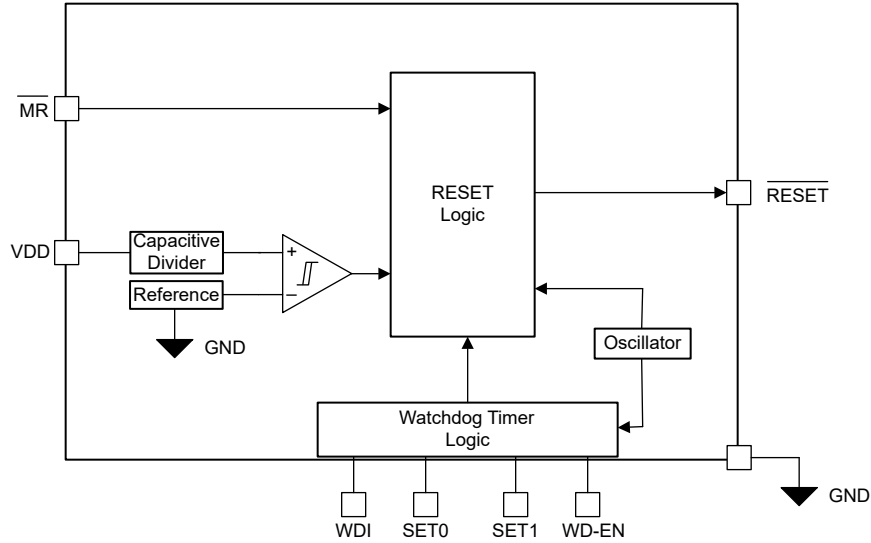


図 7-3. ピン配置オプション C

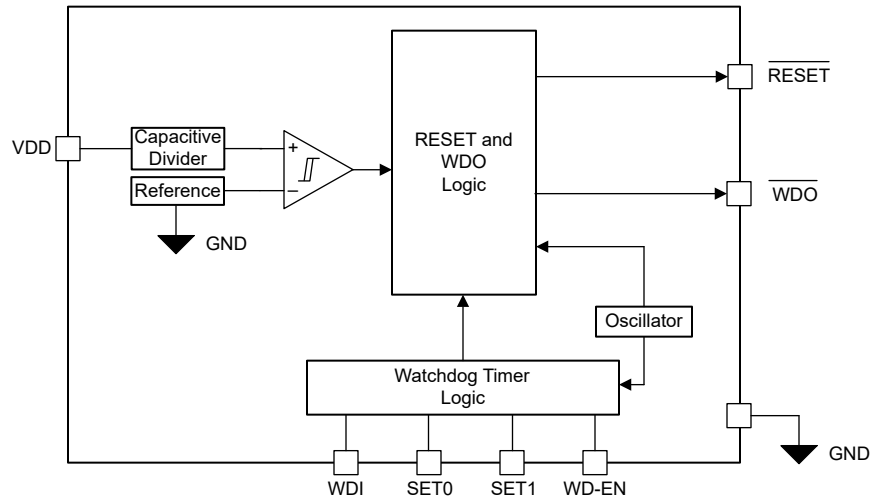


図 7-4. ピン配置オプション D

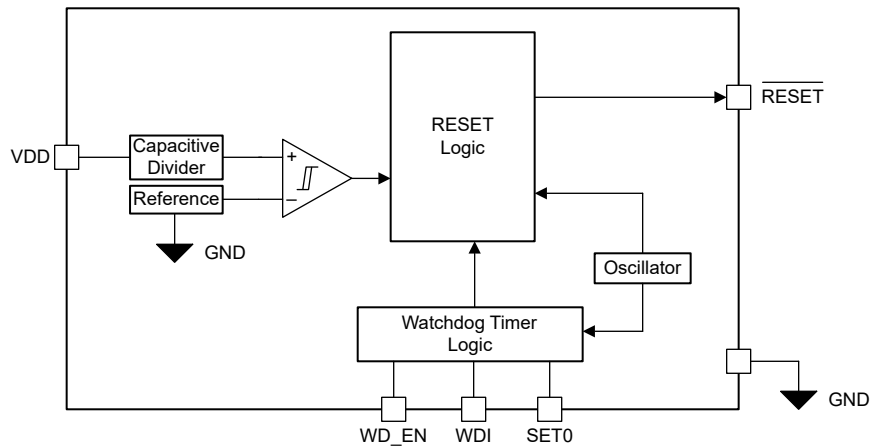


図 7-5. ピン配置オプション J

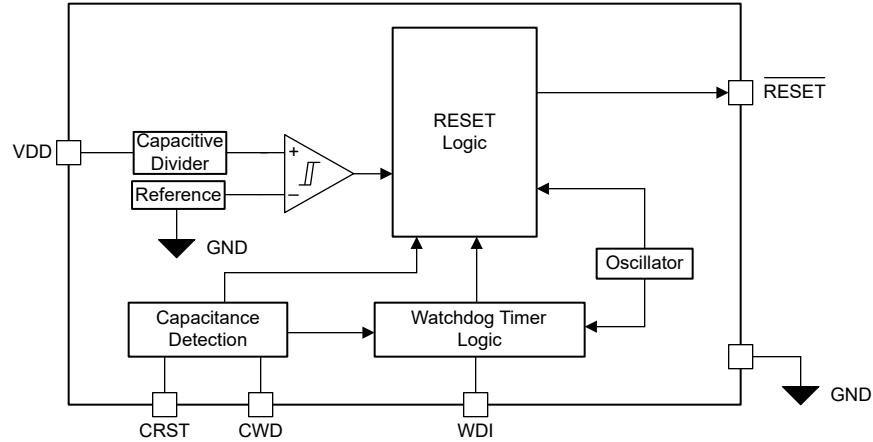


図 7-6. ピン配置オプション K

7.3 機能説明

7.3.1 電圧監視

TPS35 は、非常に低い静止電流で高精度の低電圧スーパーバイザ機能を提供します。電圧スーパーバイザ機能は常にアクティブです。デバイスが $V_{DD} < V_{POR}$ から起動した後、 V_{DD} が V_{POR} を超えたときに RESET および WDO 出力がアクティブに駆動されます。 V_{DD} 電圧が 1.04V を超えると、デバイスは電源レベルの監視を開始します。 V_{DD} が V_{IT+} ($V_{IT-} + V_{HYS}$) を超えると、 $t_{STRT} + t_D$ の時間 RESET ピンがアサートに保持されます。 t_D 値の計算については、[セクション 7.3.4](#) を参照してください。コンデンサベースの t_D 遅延オプションでは、CRST ピンが断線している場合、RESET は $t_{STRT} + 2$ ミリ秒アサートされます。

デバイスのピン配置オプション A~C および J、K は、RESET 出力のみを提供します。これらのデバイスでは、スーパーバイザからの内部 RESET 出力と、ウォッチドッグ タイマからの WDO 出力が AND 接続され、外部 RESET 出力が駆動されます。

このスーパーバイザでは、1.05V~5.40V の広い範囲で 50mV 刻みの固定監視スレッシュホールド (V_{IT-}) を使用できます。 V_{DD} 信号が V_{IT-} スレッシュホールドを下回ると、デバイスは RESET 出力をアサートします。このデバイスには、電圧監視用のヒステリシス機能があります。これにより、RESET 出力がデアサートされる前に、電源が監視スレッシュホールドを超える電圧に回復するようになります。TPS35 の代表的な電圧ヒステリシス (V_{HYS}) は 5% です。電圧ヒステリシスに加え、デバイスの電源が V_{IT+} を超えた後、 t_D の間は RESET 出力がアサートされたままになります。 V_{DD} 信号が V_{POR} 未満の電圧から上昇している場合、RESET 出力のアサート時間は t_D から $t_{STRT} + t_D$ に変わります。 t_D の期間は、外付けコンデンサまたはデバイスで使用可能な固定時間オプションを使用してプログラムできます。

[図 7-7](#) に、電圧スーパーバイザと RESET 出力の代表的なタイミング動作を示します。電圧スーパーバイザの監視出力は、ウォッチドッグ機能よりも優先順位が高くなっています。デバイスの電圧スーパーバイザ出力がアサートされると、WDO アサート制御を含むウォッチドッグ機能がディセーブルになります。デバイスのウォッチドッグ関連機能は、電源が安定し、 t_D の時間が経過した後に再開します。

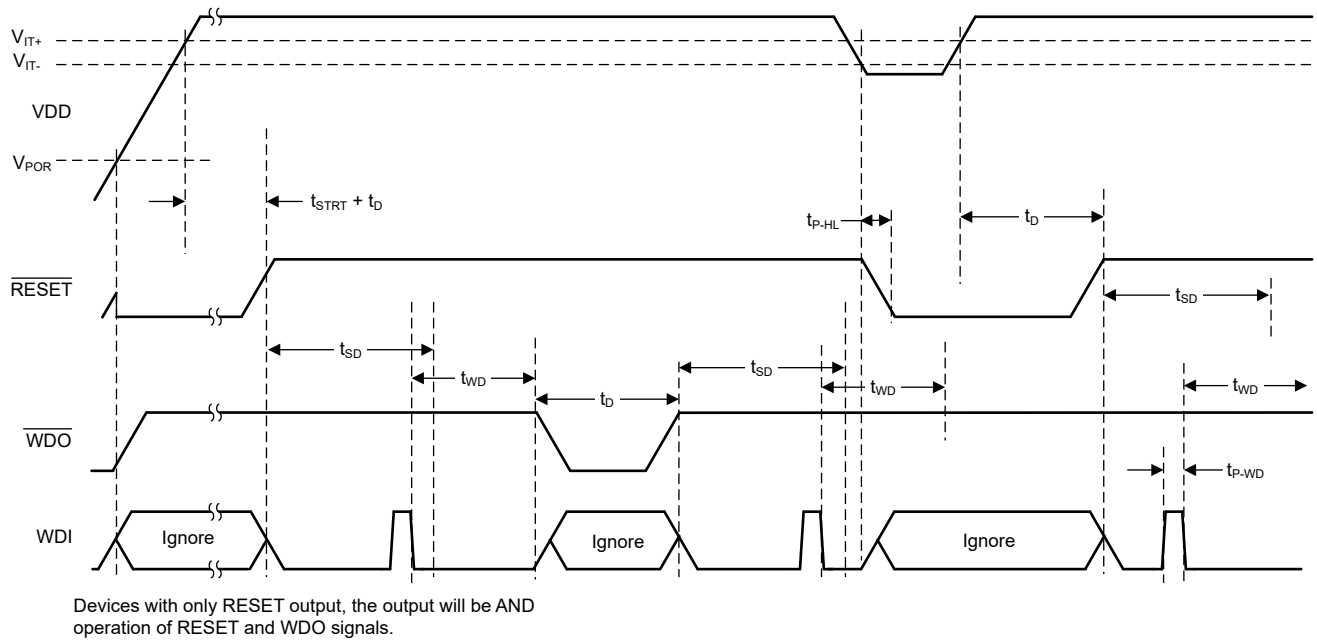


図 7-7. 電圧スーパバイザのタイミング図

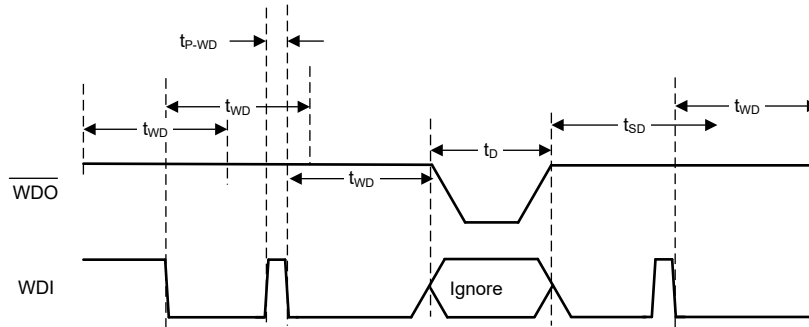
7.3.2 タイムアウト ウォッチドッグ タイマ

TPS35 は、高精度のタイムアウト ウォッチドッグ タイマ監視機能を備えています。このデバイスは、複数の機能をサポートする A~K の複数のピン配置オプションで提供されており、さまざまなアプリケーションの高まるニーズに対応しています。アプリケーションのニーズを満たす適切なピン配置が選択されていることを確認してください。

タイムアウト ウォッチドッグは、VDD 電圧が $V_{IT+} + V_{HYS}$ より高くなり、 t_D 時間後に RESET がデアサートされるとアクティブになります。ウォッチドッグは、VDD が V_{IT-} を上回っており、ウォッチドッグがイネーブルであれば、アクティブのままになります。TPS35 ファミリには、ホストがブート動作を完了するのに十分な時間を確保できるように、さまざまなスタートアップ時間遅延オプションが用意されています。詳細については、[セクション 7.3.2.3](#) を参照してください。

タイムアウト ウォッチドッグ タイマは、 t_{WD} で定義されたタイムフレームの間、WDI ピンの立ち下がりエッジを監視します。アプリケーションに必要な t_{WD} 値の算出方法については、[セクション 7.3.2.1](#) セクションを参照してください。 t_{WD} の期間内に WDI ピンで有効な立ち下がりエッジが検出されると、タイマ値はリセットされます。 t_{WD} の期間内に有効な WDI 遷移が検出されない場合、ピン配置オプション A、B、C、J、K では RESET 出力がアサートされ、ピン配置 D では WDO 出力がアサートされます。RESET または WDO は、 t_D の期間アサートされます。アプリケーションに必要な t_D 値の算出方法については、[セクション 7.3.4](#) を参照してください。

図 7-8 に、タイムアウト ウォッチドッグ タイマの基本動作を示します。TPS35 のウォッチドッグは、複数の機能をサポートしています。詳細については、以下のサブセクションを参照してください。



Devices with only RESET output, the RESET output will be asserted when watchdog error occurs.

図 7-8. タイムアウト ウォッチドッグ タイマの動作

7.3.2.1 t_{WD} タイマ

TPS35 の t_{WD} タイマは、CWD ピンと GND ピンの間に接続された外付けコンデンサを使用して設定できます。この機能は、ピン配置オプション A、B、K で利用できます。スペースに制約があるアプリケーションや、提供されているタイマ オプションを満たすタイマ値が必要なアプリケーションでは、ピン配置オプション C または D または J を使用すると便利です。TPS35 は、1ms ~ 100s の範囲で複数の固定タイマ オプションを提供しています。

TPS35 では、容量ベースのタイマを使用すると、電源オン時または RESET イベント後に容量値が検出されます。容量値を検出するため、既知の内部電流源を使用してコンデンサを 1 サイクル充電および放電します。検出された値を使用して、ウォッチドッグ動作の t_{WD} タイマを求めます。この独自の実装により、コンデンサの連続充電 / 放電電流を低減し、全体的な消費電流を低減できます。容量の連続充電と放電により、コンデンサ放電中のデッドタイムが長くなります (ウォッチドッグ モニタ機能なし)。容量の値が大きいと、デッドタイムは長くなります。TPS35 の独自の実装により、通常動作中は容量が連続的に充電または放電されることがないため、デッドタイムを回避できます。容量を正確にキャリブレーションするため、 C_{CWD} が $200 \times C_{CRST}$ 未満であることを確認してください。式 1 に、 t_{WD} (秒) と CWD 容量 (ファラッド) の関係を示します。 t_{WD} タイマは、理想的なコンデンサに対して 20% の精度になります。容量の精度は、 t_{WD} 時間にさらに影響を与えます。容量が推奨動作範囲を満たしていることを確認してください。容量が推奨範囲外の場合、デバイスの誤動作につながる可能性があります。

$$t_{WD} \text{ (秒)} = 4.95 \times 10^6 \times C_{CWD} \text{ (F)} \quad (1)$$

TPS35 は、業界標準のさまざまな値を含め、1ms ~ 100s の範囲で幅広い高精度の固定タイマ オプションを提供しています。TPS35 の固定時間オプションでは、 $t_{WD} \geq 10\text{ms}$ での精度は $\pm 10\%$ です。 t_{WD} が 10ms 未満の場合、精度は $\pm 20\%$ です。アプリケーションに関連する t_{WD} の値は、注文可能な部品番号から識別できます。注文可能な部品番号と t_{WD} 値のマッピングについては、[セクション 4](#) セクションを参照してください。

TPS35 では、SETx ピンのロジック レベルを制御することで、 t_{WD} 値を動作中に変更できる柔軟性を備えています。[セクション 7.3.2.4](#) セクションでは、この機能の利点と、さまざまな SETx ピンの組み合わせによるデバイスの動作について説明します。

7.3.2.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作

TPS35 では、ウォッチドッグをイネーブルまたはディセーブルする機能がサポートされています。この機能は、以下に示すさまざまな使用事例で重要です。

- ホストのリセットを回避するため、ファームウェアの更新中にウォッチドッグをディセーブルする。
- ソフトウェアのステップバイステップ・デバッグ動作中にウォッチドッグをディセーブルする。
- ウォッチドッグのエラー割り込みを回避するため、重要なタスクを実行するときにウォッチドッグをディセーブルする。
- ホストが起動するまで、ウォッチドッグをディセーブルに保持する。

TPS35 では、WD-EN ピン (ピン構成 C)、SET[1:0] = 0b'01 (ピン構成 B) ロジックの組み合わせにより、ウォッチドッグのイネーブルまたはディセーブル機能がサポートされています。特定のピン配置でユーザーがウォッチドッグ動作をディセーブルにするのに使用できるのは、これらの方法のいずれか 1 つのみです。

WD-EN ピンのあるピン配置では、ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブルは WD-EN ピンのロジック状態で制御されます。WD-EN を 1 に駆動するとウォッチドッグ動作がイネーブルになり、WD-EN を 0 に駆動するとウォッチドッグ動作がディセーブルになります。WD-EN ピンは、デバイスの動作中いつでも切り替えることができます。図 7-9 の図に、WD-EN ピンの制御によるタイミング動作を示します。

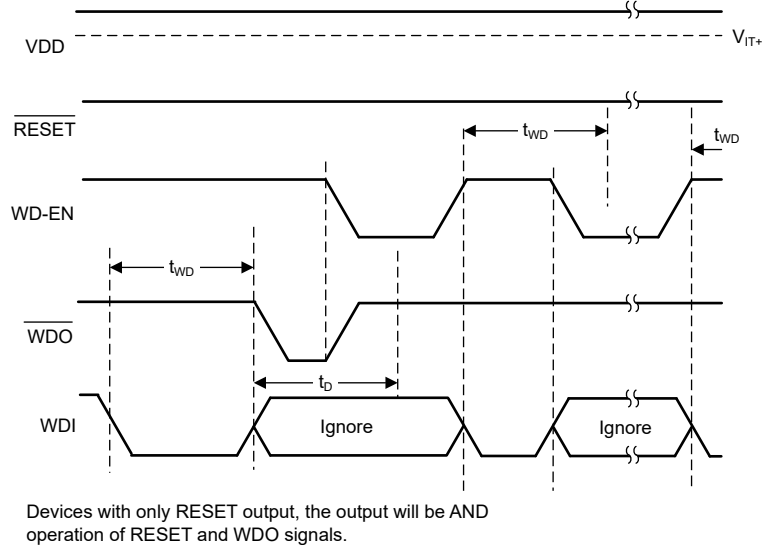


図 7-9. ウォッチドッグのイネーブル : WD-EN ピンの制御

SET[1:0] = 0b'01 の組み合わせは、SET1 ピンと SET0 ピンがあり、WD-EN ピンがないピン配置でウォッチドッグ動作をディセーブルにするのに使用できます。SET ピンのロジック状態は、ウォッチドッグ動作中いつでも変更できます。SET[1:0] ピンの動作の詳細については、[セクション 7.3.2.4](#) セクションを参照してください。

ピン配置オプション A、B、K では、CWD ピンと GND ピンの間に接続された容量を使用して、ウォッチドッグ・タイマを制御できます。容量値が推奨値よりも大きいと、GND に接続すると、ウォッチドッグ機能がディセーブルになります。容量ベースのディセーブル動作は、上記の他の 2 つのオプションよりも優先されます容量を動作中に変更しても、ウォッチドッグ動作はイネーブルまたはディセーブルになりません。容量の変化を検出するには、電源リサイクル、UV フォルト後のデバイス回復、MR の Low イベントが必要です。

ウォッチドッグがディセーブルになると、進行中のウォッチドッグ・フレームは終了します。ウォッチドッグ動作がディセーブルの場合、WDO はデアサートされたままになります。RESET 出力のみのピン配置では、電源スーパーバイザでエラーが発生すると、RESET がアサートされます。イネーブルになると、デバイスは直ちに t_{WD} フレームに入り、ウォッチドッグ監視動作を開始します。

7.3.2.3 t_{SD} ウォッチドッグのスタートアップ遅延

TPS35 は、ウォッチドッグのスタートアップ遅延機能をサポートしています。この機能は、電源オン後、RESET アサート・イベント後、または WDO アサート・イベント後にアクティブになります。 t_{SD} フレームがアクティブになると、デバイスは WDI ピンを監視しますが、WDO 出力はアサートされません。この機能により、ウォッチドッグ監視が開始する前に、ホストがブート・プロセスを完了することができます。スタートアップ遅延を使用すると、起動中に予期しない WDO または RESET アサート・イベントを回避できます。 t_{SD} 時間は、選択したデバイスの部品番号に基づいてあらかじめ決められています。部品番号と t_{SD} 時間のマッピングの詳細については、[セクション 4](#) セクションを参照してください。ピン配置オプション A、B、K には、遅延なし、または 10 秒のスタートアップ遅延オプションのみがあります。

t_{SD} フレームは、 t_{SD} に選択された期間が経過するか、ホストが WDI ピン状に有効な遷移を供給すると完了します。ホストは、 t_{SD} 期間中に WDI ピンに有効な遷移を供給する必要があります。デバイスは t_{SD} フレームを

終了し、有効な WDI 遷移後にウォッチドッグ監視フェーズに入ります。WDI ピンに有効な遷移が供給されないと、WDO 出力ピンがアサートされ、ウォッチドッグ・エラーがトリガされます。RESET 出力のみを持つデバイスでは、RESET ピンがアサートされます。

セクション 7.3.2.2 セクションで説明されているように、WD-EN ピン、SET[1:0] ピンの組み合わせを使用してウォッチドッグ機能がイネーブルになっている場合、 t_{SD} フレームは開始しません。

図 7-10 に、 t_{SD} タイム・フレームの動作を示します。

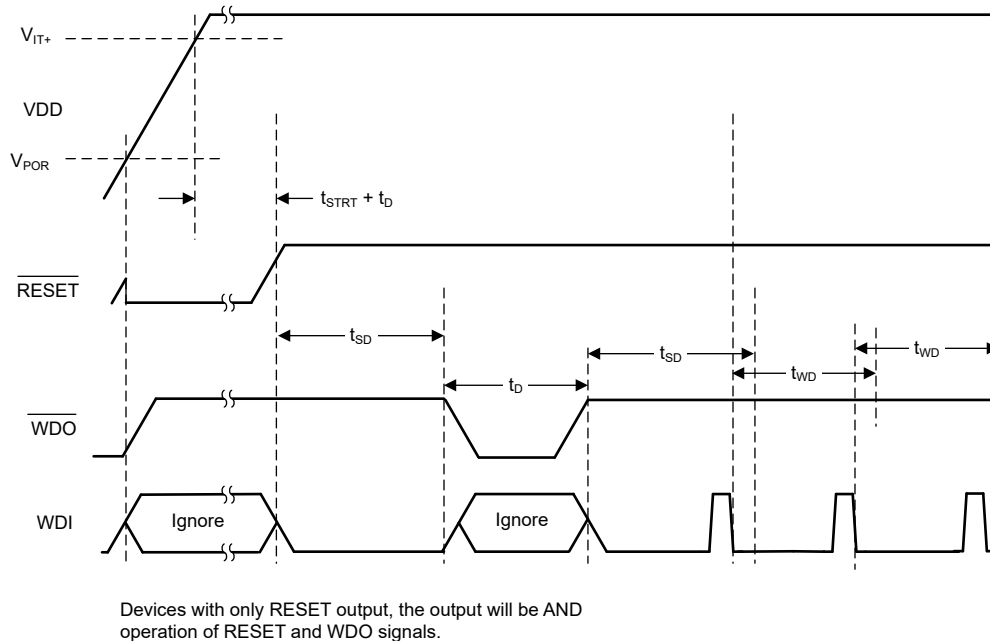


図 7-10. t_{SD} フレームの動作

7.3.2.4 SET ピンの動作

TPS35 には、選択したピン配置オプションによって、1 本または 2 本の SET ピンがあります。SET ピンを使用すると、さまざまなアプリケーション要件に合わせて、 t_{WD} タイマを動作中にプログラムすることができます。SET ピンを使用できる代表的な使用事例は次のとおりです。

- ホストがスリープ・モードのときは広いタイムアウト・タイマを使用し、ホストが動作しているときはタイムアウトの短い動作に変更。ウォッチドッグを使用して、長時間経過した後にホストをウェイクアップし、スリープに戻る前にアプリケーション関連のアクティビティを実行することが可能。
- ウォッチドッグにより重要なタスクが中断されないように、システム・クリティカルなタスクを実行するときに幅の広いタイムアウト・タイマに変更。重要なタスクの完了後は、タイマをアプリケーション指定の間隔に変更。

デバイスの t_{WD} タイマ値は、CWD ピンまたは固定タイマ値に基づくタイマの選択と、SET ピンのロジック・レベルを組み合わせで決定されます。ベース t_{WD} タイマ値は、セクション 4 セクションのウォッチドッグ時間セレクトに基づいて決定されます。SET ピンのロジック・レベルは、デバイスの電源投入時にデコードされます。SET ピンの値は、動作中いつでも変更できます。SETx ピンが変化すると、ウォッチドッグ・タイマ値またはイネーブル / ディセーブル状態が変化し、進行中のウォッチドッグ・フレームがただちに終了します。SETx ピンは、WDO または RESET 出力がアサートされたときにも更新されます。更新された t_{WD} タイマ値は、出力がデアサートされ、 t_{SD} タイマが終了した後に適用されます。

SET0 ピンのみを持つピン配置の場合、 t_{WD} の乗数値は、セクション 4 セクションに示すウォッチドッグ時間スケール・セレクトに基づいて決定されます。表 7-1 に、ウォッチドッグ時間をオプション D = 10ms に設定した場合の、異なる SET0 ロジック・レベルの t_{WD} 値の例を示します。

表 7-1. SET0 ピンのみの場合の t_{WD} スケーリング (ピン構成 A、J)

ウォッチドッグ時間スケーリングの選択	t_{WD}	
	SET0 = 0	SET0 = 1
A	10ms	20ms
B	10ms	40ms
C	10ms	80ms
D	10ms	160ms
E	10ms	320ms
F	10ms	640ms
G	10ms	1280ms

SET0 と SET1 ピンの両方を持つピン配置の場合、 t_{WD} の乗数値は、セクション 4 セクションに示すウォッチドッグ時間スケーリング・セレクトに基づいて決定されます。2 本の SETx ピンにより、3 つの時間スケーリング・オプションが提供されます。SET[1:0] = 0b'01 の場合、ウォッチドッグ動作はディセーブルになります。表 7-2 に、ウォッチドッグ時間をオプション G = 100ms に設定した場合の、異なる SET[1:0] ロジック・レベルの t_{WD} 値の例を示します。選択されたパッケージ・ピン配置には、WD-EN ピンはありません。

表 7-2. SET0 および SET1 ピンの両方がある場合の t_{WD} スケーリング、WD-EN ピンなし (ピン構成 B)

ウォッチドッグ時間スケーリングの選択	t_{WD}			
	SET[1:0] = 0b'00	SET[1:0] = 0b'01	SET[1:0] = 0b'10	SET[1:0] = 0b'11
A	100ms	ウォッチドッグはディセーブル	200ms	400ms
B	100ms	ウォッチドッグはディセーブル	400ms	800ms
C	100ms	ウォッチドッグはディセーブル	800ms	1600ms
D	100ms	ウォッチドッグはディセーブル	1600ms	3200ms
E	100ms	ウォッチドッグはディセーブル	3200ms	6400ms
F	100ms	ウォッチドッグはディセーブル	6400ms	12800ms
G	100ms	ウォッチドッグはディセーブル	12800ms	25600ms

選択されたパッケージ・ピン配置には、SET[1:0] に加えて WD-EN ピンがあります (ピン構成 C、D)。このピン配置では、WD-EN ピンでウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作を制御します。SET[1:0] = 0b'01 の場合は、SET[1:0] = 0b'00 と同様に動作します。

SETx 乗数での t_{WD} 値が 640 秒を超えないようにしてください。タイマと乗数の選択により t_{WD} が 640 秒を超える場合、タイマ値は 640 秒に制限されます。

図 7-11 ~ 図 7-13 の図に、SETx ステータスの変化に対するタイミング動作を示します。

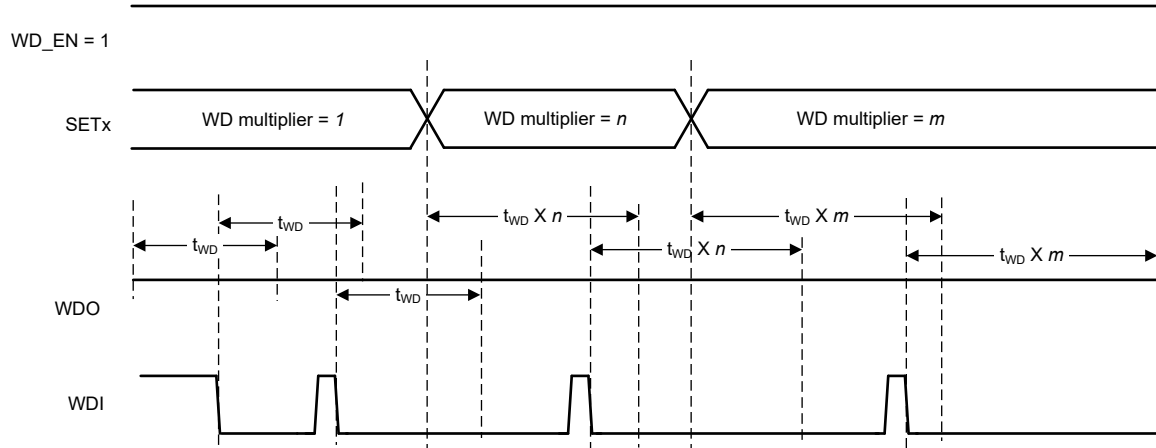
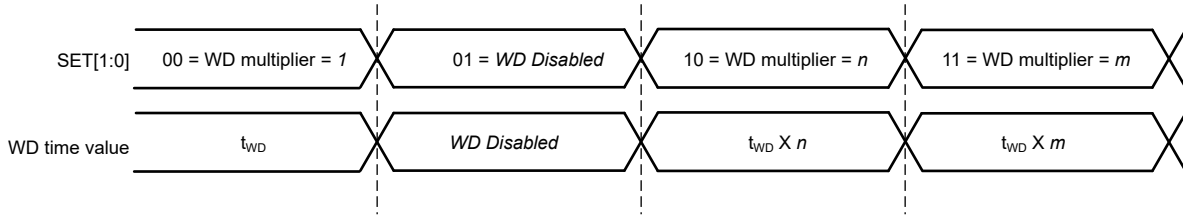
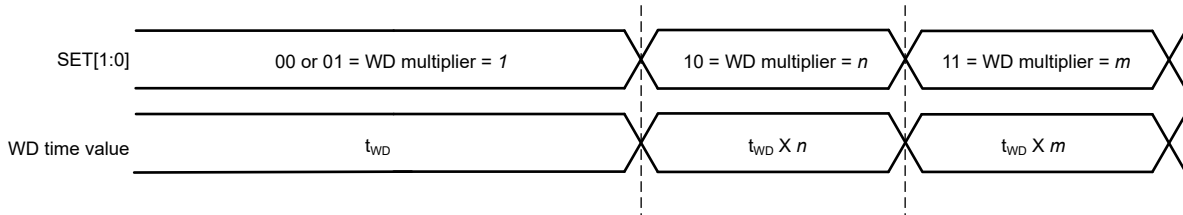


図 7-11. SETx ピンのステータスによるウォッチドッグ動作

SET Pin (2 Pins) Operation; WD_EN pin Not available

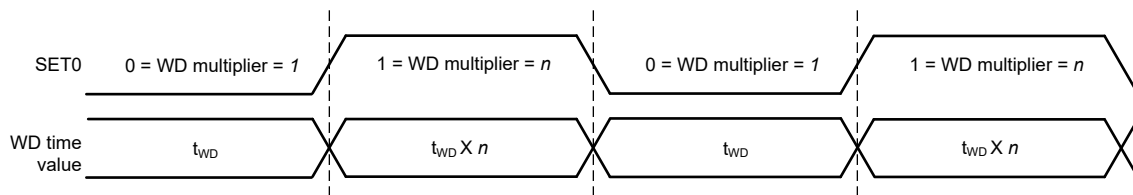


SET Pin (2 Pins) Operation; WD_EN available = 1



t_{WD} = Fixed based on OPN or programmable using capacitor
 n, m = Fixed based on timeset multiplier chosen

図 7-12. 2 本の SET ピンによるウォッチドッグ動作



t_{WD} = Fixed based on OPN or programmable using capacitor
 n = Fixed based on timeset multiplier chosen

図 7-13. 1 本の SET ピンによるウォッチドッグ動作

7.3.3 手動リセット

TPS35 では、 \overline{MR} ピンを使用した手動リセット機能がサポートされています。 \overline{MR} ピンを $0.3 \times V_{DD}$ より低い電圧で駆動すると、RESET 出力がアサートされます。 \overline{MR} ピンは $100\text{k}\Omega$ のプルアップ抵抗で V_{DD} に接続されています。 \overline{MR} ピンはフローティングのままかまいません。内部プルアップにより、 \overline{MR} ピンがトリガされたときに出力がアサートされないようになっています。

\overline{MR} ピンの電圧が $0.7 \times V_{DD}$ 電圧を超え、 t_D が経過すると、出力がデアサートされます。詳細については、[図 7-14](#) を参照してください。

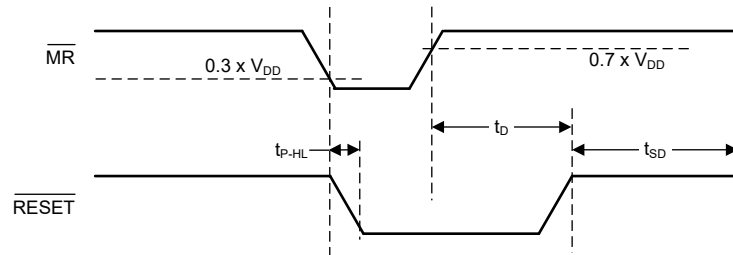


図 7-14. MR ピンの応答

7.3.4 RESET および WDO 出力

TPS35 デバイスは、RESET ピンのみ、または RESET ピンと独立した WDO 出力ピンを備えています。出力の構成は、選択したピン配置バリエーションによります。RESET 出力のみを持つピン配置の場合、VDD 電圧が監視対象のスレッシュホールドを下回るか、MR ピンの電圧がスレッシュホールドを下回るか、ウォッチドッグ タイマのエラーが検出されると、RESET 出力がアサートされます。独立した RESET と WDO 出力ピンを持つピン配置の場合、VDD 電圧が監視対象のスレッシュホールドを下回るか、MR ピンの電圧がスレッシュホールドを下回ると、RESET 出力がアサートされます。WDO 出力は、ウォッチドッグ タイマのエラーが検出されたときのみアサートされます。RESET エラーは、WDO エラーよりも優先度が高くなっています。WDO がアサートされているときに RESET がアサートされると、RESET ピンがデアサートされてスタートアップ遅延フレームが終了するまで、WDO ピンがデアサートされ、ウォッチドッグがディセーブルになります。

上記の関連イベントが検出されると、出力が t_D の間アサートされます。 t_D の時間は、CRST ピンと GND の間にコンデンサを接続することでプログラムできます。または、注文可能な部品番号で選択された期間 t_D がアサートされます。利用可能なオプションについては、[セクション 4](#) セクションを参照してください。

式 2 に、コンデンサ値と t_D の期間との関係を示します。容量が推奨動作範囲を満たしていることを確認してください。容量が推奨範囲外の場合、デバイスの誤動作につながる可能性があります。

$$t_D (\text{秒}) = 4.95 \times 10^6 \times C_{\text{CRST}} (\text{F}) \quad (2)$$

TPS35 には、ラッチ付き出力のオプションも備えています。ラッチ付き出力を備えた注文可能な部品番号では、デバイスの電源を切って再投入するか、エラー状態を解消するまで、出力がアサート状態に保持されます。電圧スーパーバイザの低電圧検出により出力がラッチされた場合、VDD 電圧が $V_{\text{IT-}} + V_{\text{HYS}}$ レベルを上回ると、出力ラッチが解除されます。MR ピンの電圧が低くなったために出力がラッチされた場合、MR ピンの電圧が $0.7 \times V_{\text{DD}}$ レベルを上回ると、出力ラッチが解除されます。ウォッチドッグ タイマのエラーが原因で出力がラッチされた場合、WDI で負のエッジが検出されたとき、またはデバイスがシャットダウンされて再度電源が投入されたときに、出力ラッチが解除されます。[図 7-15](#) に、ラッチ付き出力構成でのデバイスのタイミング動作を示します。

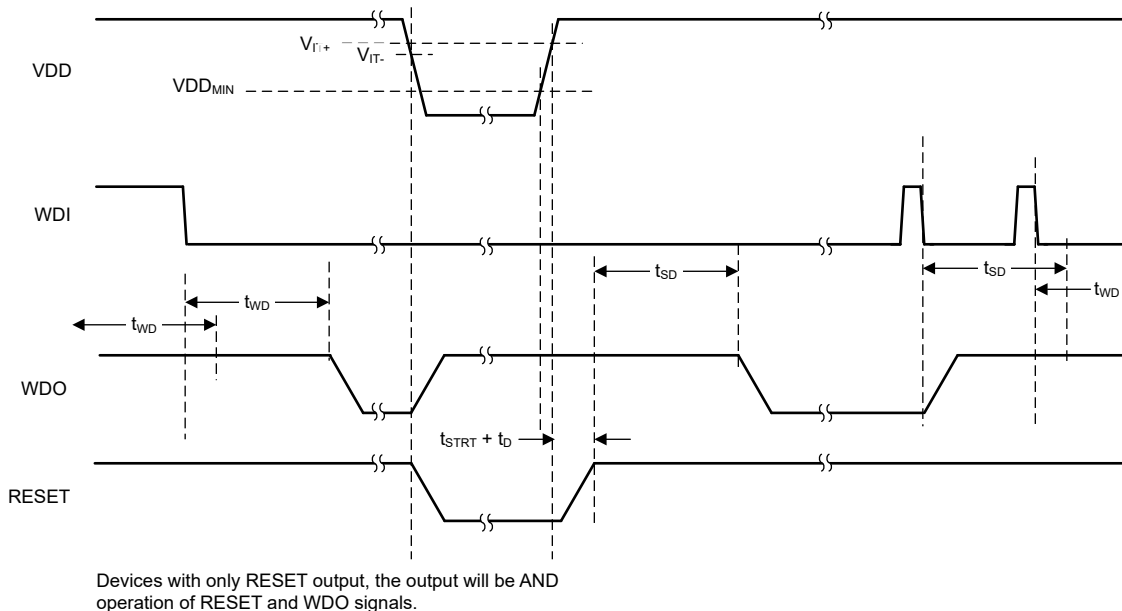


図 7-15. 出力ラッチのタイミング動作

7.4 デバイスの機能モード

表 7-3 に、TPS35 の機能モードを示します。

表 7-3. デバイスの機能モード

VDD	ウォッチドッグ・ステータス	WDI	WDO	RESET
$V_{DD} < V_{POR}$	該当なし	—	未定義	未定義
$V_{POR} \leq V_{DD} < V_{IT-}$	該当なし	無視	High	Low
$V_{DD} \geq V_{IT+}$	無効化	無視	High	High
	イネーブル	$t_{pulse}^1 < t_{WD(min)}$	High	High
	イネーブル	$t_{pulse}^1 > t_{WD(max)}$	Low	High

(1) t_{pulse} は WDI の立ち下がりエッジ間の時間です。

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証してテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

以下のセクションでは、最終アプリケーションの要件に応じた適切なデバイス実装について詳しく説明します。

8.1.1 出力アサート遅延

TPS35 には、出力アサート遅延 (t_D) を設定するのに、固定タイミングを使用する方法と、外付けコンデンサを使用してタイミングをプログラミングする方法の 2 つのオプションがあります。

8.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング

固定出力アサート遅延タイミングは、ピン配置 C および D および J で使用できます。これらのタイミングを使用すると、高精度で 10% 精度の出力アサート遅延タイミングを実現できます。

8.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能

TPS35 は、プログラマブル出力アサート遅延も利用し、高精度の電流源を使用して、デバイスのスタートアップ時に外部コンデンサを充電します。CRST ピンの外部容量により発生する遅延時間の代表値は、式 3 で計算できます。ここで、 t_D は出力アサート遅延時間 (秒)、 C_{CRST} は容量 (マイクロファラッド) です。

$$t_D (\text{秒}) = 4.95 \times 10^6 \times C_{CRST} (\text{F}) \quad (3)$$

計算された出力アサート遅延時間と実際の出力アサート遅延時間との差を最小限に抑えるため、高品質のセラミック誘電 COG、X5R、または X7R コンデンサを使用して、このピン周辺の寄生基板容量が最小になるようにしてください。表 8-1 に、理想的なコンデンサ値に対する出力アサート遅延時間を示します。

表 8-1. 一般的な理想コンデンサ値における出力アサート遅延時間

C_{CRST}	出力アサート遅延時間 (t_D)			単位
	最小値 ⁽¹⁾	代表値	最大値 ⁽¹⁾	
10nF	39.6	49.5	59.4	ms
100nF	396	495	594	ms
1 μ F	3960	4950	5940	ms

(1) 最小値と最大値は、理想的なコンデンサを使用して計算されています。

8.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能

TPS35 には、ウォッチドッグ・タイマ (t_{WD}) を設定するのに、固定タイミングを使用する方法と、外付けコンデンサを使用してタイミングをプログラミングする方法の 2 つのオプションがあります。

8.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション

固定ウォッチドッグ・タイムアウト・オプションは、ピン配置 C および D および J で使用できます。これらのタイミングを使用すると、高精度で 10% 精度のウォッチドッグ・タイマ t_{WD} を実現できます。

8.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能

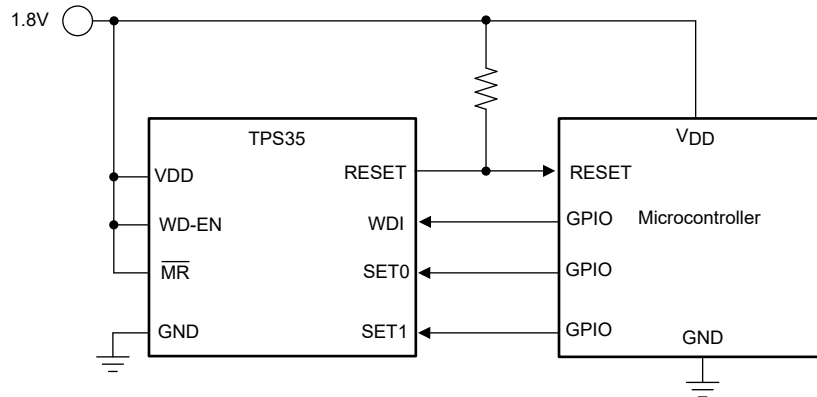
コンデンサを CWD ピンに接続すると、 t_{WD} のタイミングを調整できます。この方法を使用する場合は、理想的なコンデンサを使用した t_{WD} の代表値を計算する方法について、式 1 を参照してください。コンデンサの許容

誤差により、デバイスの実際のタイミングにおいて t_{WD} の最小値が減少し、 t_{WD} の最大値が増加することがあります。タイミングを正確なものにするため、COG 誘電体で製造されたセラミック・コンデンサを使用してください。

8.2 代表的なアプリケーション

8.2.1 設計 1：マイクロコントローラの電源電圧とウォッチドッグ タイマの監視

TPS35 は、高精度 (最大値 1.2%) の電圧監視と即座に調整可能なウォッチドッグ タイミングを備えており、システム内の重要な処理素子を監視します。



Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated

図 8-1. マイクロコントローラ電源とウォッチドッグ監視回路

8.2.1.1 設計要件

表 8-2. 設計パラメータ

パラメータ	適切な要件	設計結果
スレッシュヨルド電圧	代表的なスレッシュヨルド電圧 1.65V	代表的なスレッシュヨルド電圧 1.65V
ウォッチドッグのタイムアウト期間	代表的なタイムアウト期間 1.6s	代表的なタイムアウト期間 1.6s
RESET 遅延	代表的なリセット遅延 200ms	代表的なリセット遅延 200ms
スタートアップ遅延	最小スタートアップ遅延 700ms	最小スタートアップ遅延 900ms
出力ロジック	オープン・ドレイン	オープン・ドレイン
最大デバイス消費電流	20 μ A	250nA (代表値)、3 μ A (最大値)

8.2.1.2 詳細な設計手順

8.2.1.2.1 電圧スレッシュヨルドの設定

負方向スレッシュヨルド電圧 V_{IT-} は、デバイスのバリエーションによって設定されます。式 4 に、注文可能な部品番号の「スレッシュヨルド電圧」セクションの計算方法を示します。

$$\text{OPN 「スレッシュヨルド電圧」 値} = (V_{IT-} - 1) / 0.05 \quad (4)$$

この例では、マイクロコントローラの公称電源電圧は 1.8V です。最小電源電圧は公称電源電圧よりも 10% 低い 1.62V です。スレッシュヨルドを 1.65V に設定すると、電源電圧が許容される最小値に達する直前にデバイスが確実にリセットされます。そのため 1.65V のスレッシュヨルドが選択され、式 4 を使用すると、部品番号は TPS35xx13xxxxxxx になります。ヒステリシスの代表値は 5% であるため、正方向のスレッシュヨルド電圧 V_{IT+} は 1.73V です。

8.2.1.2.2 ウォッチドッグ・タイムアウト期間への合致

ウォッチドッグ・タイムアウトの設計要件は、TPS35 の固定タイムアウト・バージョンを使用するか、CWD ピンと GND の間にコンデンサを接続することで満たすことができます。代表値は、事前にプログラムされた固定時間オプションで満たすことができるため、固定時間オプションのあるピン配置を選択します。固定タイムアウトのリストについては、「[タイミング要件](#)」を参照してください。CWD 機能を使用する場合は、ピン配置 A または B を使用する必要があります。タイムアウト期間のプログラム方法については、 t_{WD} タイマを参照してください。この例の設計要件は $t_{WD} = 1.6s$ です。これは、ピン配置 C または D または J で提供される固定タイムアウト・オプションです。そのため、使用可能なバリエーション・オプションは TPS35Cx13KAXDDFR に絞り込むことができます。

8.2.1.2.3 リセット遅延の設定

リセット遅延要件は、TPS35 の固定タイムアウト・バージョンを使用するか、CRST ピンと GND の間にコンデンサを接続することで満たすことができます。代表値は、事前にプログラムされた固定時間オプションで満たすことができるため、固定時間オプションのあるピン配置を選択します。固定タイムアウトのリストについては、「[タイミング要件](#)」を参照してください。CRST 機能を使用する場合は、ピン配置 A または B を使用する必要があります。タイムアウト期間のプログラム方法については、「[タイミング要件](#)」を参照してください。この例の設計要件は、 $t_D = 200ms$ です。そのため、利用可能なバリエーション・オプションは、TPS35Cx13KAGDDFR に絞り込むことができます。

8.2.1.2.4 スタートアップ遅延と出力ポロジの設定

スタートアップ遅延と出力ポロジは、デバイスのバリエーションによって設定されます。使用可能なオプションについては、「[デバイスの比較](#)」を参照してください。最小スタートアップ遅延が 700ms で、オープン・ドレイン出力が必要なため、オプション D、代表的なスタートアップ遅延 1s とオープン・ドレインのアクティブ Low を選択します。そのため、設計要件を満たす適切なオプションは TPS35CD13KAGDDFR です。

8.2.1.2.5 RESET プルアップ抵抗の計算

図 8-2 に示すように、TPS35 は RESET 出力にオープン ドレイン構成を使用します。FET がオフになると、抵抗によってトランジスタのドレインが VDD にプルアップされ、FET がオンになると出力がグランドにプルダウンされて、実質的に分圧抵抗が形成されます。この分圧器の抵抗は、 V_{OL} が最大値未満になるよう選択する必要があります。適切なプルアップ抵抗を選択するには、プルアップ電圧 (V_{PU})、RESET ピンに推奨される最大電流 (I_{RST})、 V_{OL} の 3 つの仕様を考慮する必要があります。 V_{OL} の最大値は 0.3V です。これは、作成される実質的な分圧抵抗が RESET ピンの電圧を 0.3V 未満にでき、 $V_{DD} \geq 3V$ の場合は I_{RST} を 2mA 未満に、 $V_{DD} = 1.5V$ の場合は 500 μA 未満に維持できる必要があることを意味します。この例では、 $V_{PU} = V_{DD} = 1.5V$ なので、 I_{RST} を 500 μA 未満に維持する抵抗を選択する必要があります。この値が許容される最大消費電流です。この仕様を確実に満たすため、RESET がアサートされたときに最大 180 μA をシンクする 10k Ω のプルアップ抵抗値が選択されています。

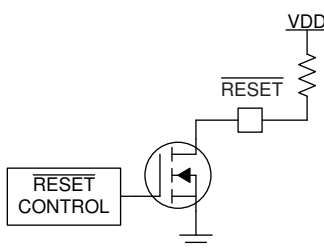


図 8-2. オープン ドレイン RESET の構成

8.3 電源に関する推奨事項

このデバイスは、1.04V ~ 6V の電圧範囲の入力電源で動作するように設計されています。このデバイスには、入力電源コンデンサは必要ありません。ただし、入力電源にノイズが多い場合は、VDD ピンと GND ピンの間に 0.1 μF のコンデンサを配置するのが適切なアナログ手法です。

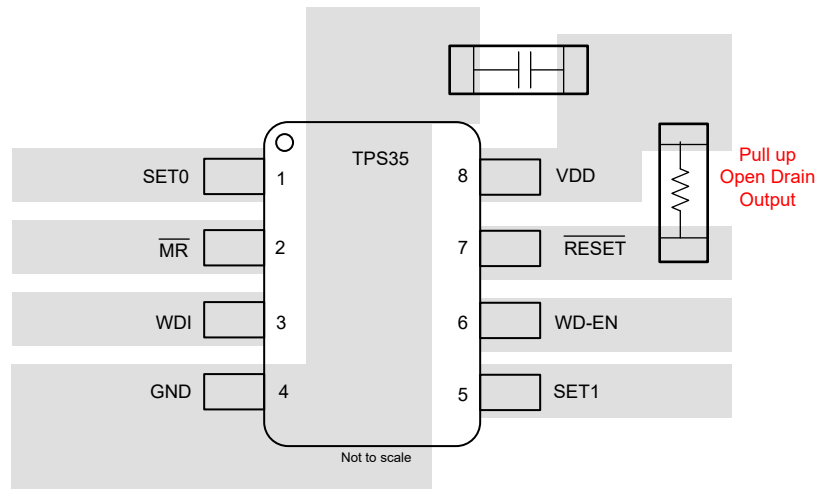
8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

VDD ピンへの接続が低インピーダンスであることを確認します。適切なアナログ設計手法では、0.1 μ F のセラミック・コンデンサを VDD ピンのできるだけ近くに配置することが推奨されます。CRST ピンにコンデンサが接続されていない場合、このピンの寄生容量を最小限に抑え、RESET 遅延時間に悪影響を与えないようにします。

- VDD ピンへの接続が低インピーダンスであることを確認します。適切なアナログ設計手法では、0.1 μ F のセラミック・コンデンサを VDD ピンのできるだけ近くに配置することが推奨されます。
- C_{CRST} コンデンサを CRST ピンのできるだけ近くに配置します。
- C_{CWD} コンデンサを CWD ピンのできるだけ近くに配置します。
- プルアップ抵抗は、RESET ピンのできるだけ近くに配置します。

8.4.2 レイアウト例



Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated

図 8-3. 以下のデバイスのピン配置 C の代表的なレイアウト： TPS35

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[\[通知\]](#) をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.2 サポート・リソース

[テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラム](#) は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (June 2023) to Revision A (December 2023)

Page

• DSE パッケージのプレビュー ステータスを削除.....	1
• DSE パッケージの「熱に関する情報」の表を追加.....	8
• TPS35-Q1 を TPS35 に置き換え.....	29

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
PPS35DA40GCJDDFR	ACTIVE	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	TBD	Call TI	Call TI	-40 to 125		Samples
TPS35AA17AGADDFR	ACTIVE	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	NLLOB	Samples
TPS35JE35JADDSER	ACTIVE	WSON	DSE	6	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	P3	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TPS35 :

- Automotive : [TPS35-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

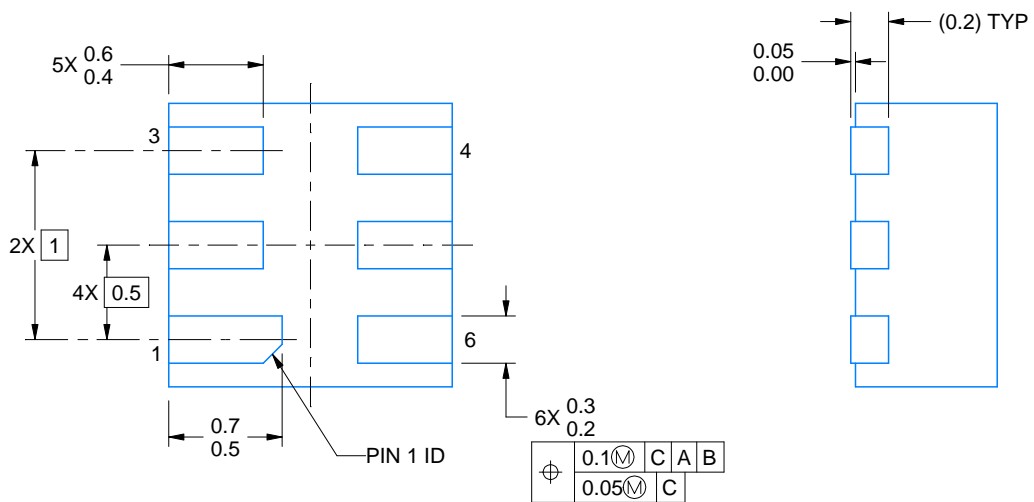
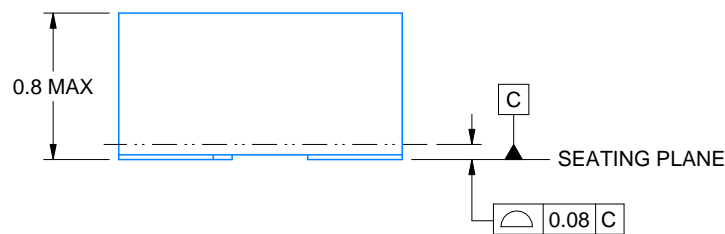
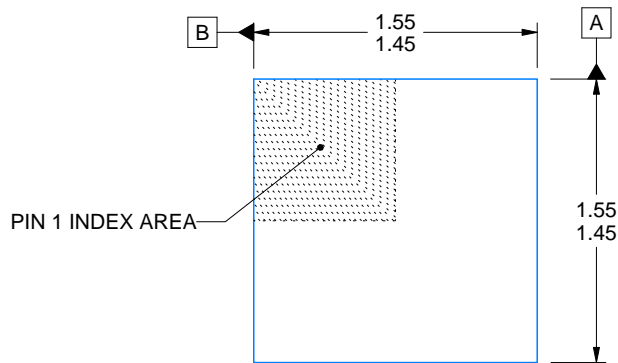

*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS35AA17AGADDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS35JE35JADDSER	WSO	DSE	6	3000	180.0	8.4	1.75	1.75	1.0	4.0	8.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS35AA17AGADDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	210.0	185.0	35.0
TPS35JE35JADDSER	WSON	DSE	6	3000	210.0	185.0	35.0



4220552/B 01/2024

NOTES:

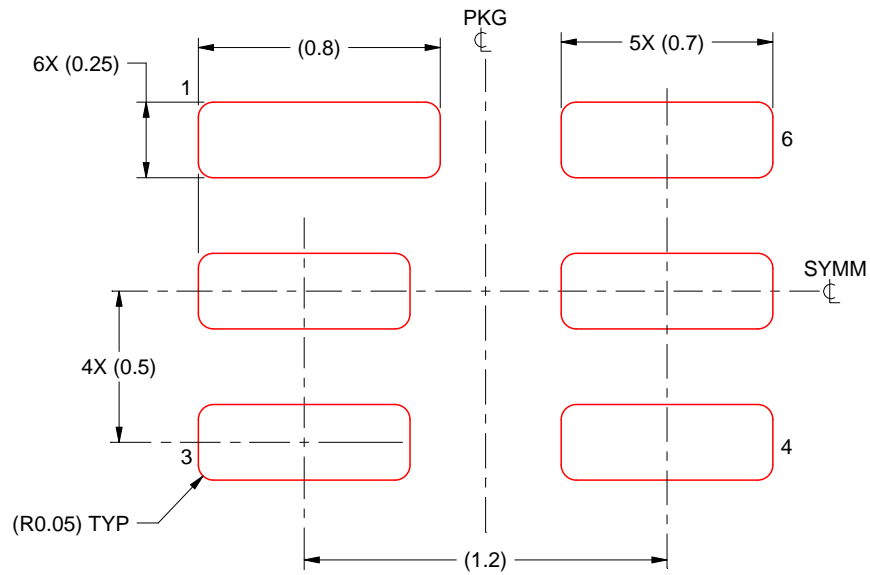
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DSE0006A

WSON - 0.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:40X

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

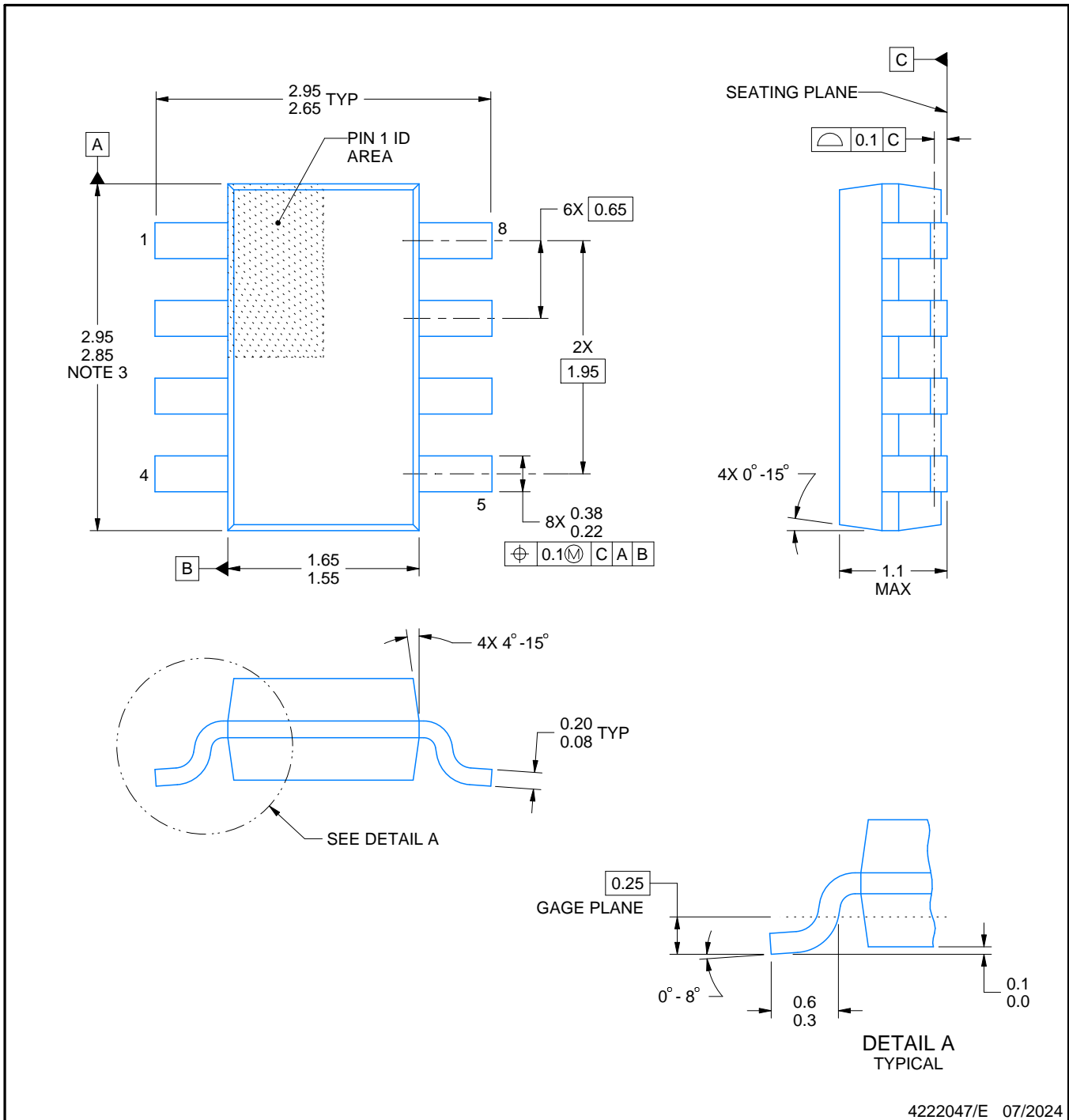
DDF0008A



PACKAGE OUTLINE

SOT-23-THIN - 1.1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



4222047/E 07/2024

NOTES:

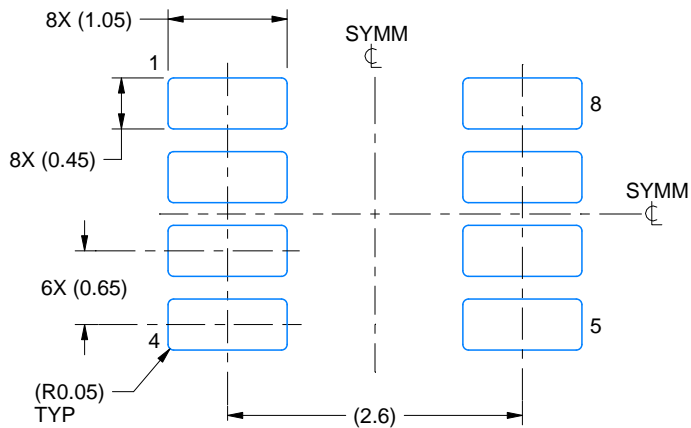
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

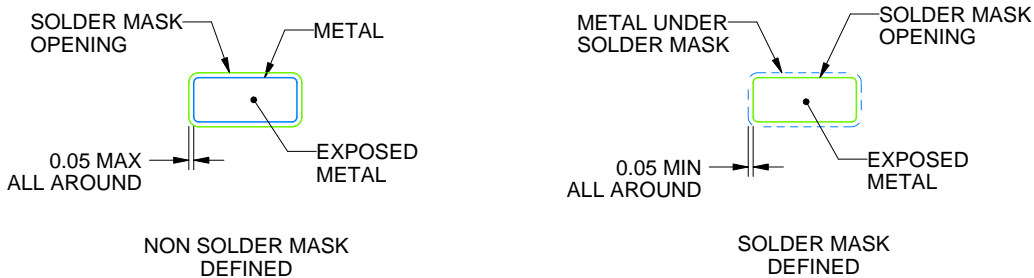
DDF0008A

SOT-23-THIN - 1.1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4222047/E 07/2024

NOTES: (continued)

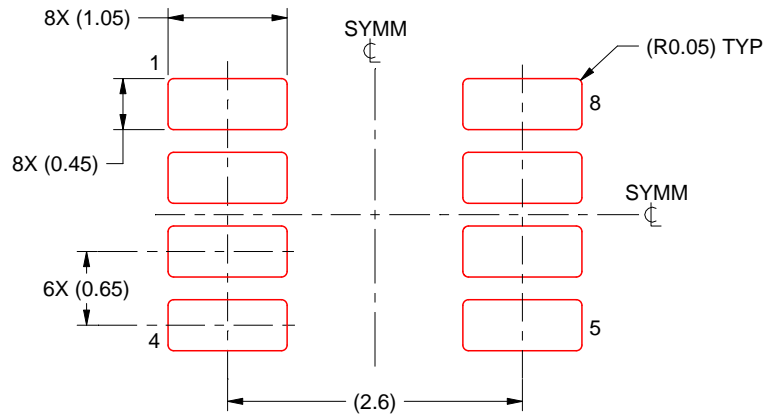
- 4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DDF0008A

SOT-23-THIN - 1.1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4222047/E 07/2024

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
7. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated